

证券代码：688025

证券简称：杰普特



深圳市杰普特光电股份有限公司
SHENZHEN JPT OPTO-ELECTRONICS CO., LTD

深圳市杰普特光电股份有限公司

(深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 A 栋 1201)

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

(申报稿)

保荐机构（主承销商）



(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二〇二六年八月

声 明

1、本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

3、中国证监会、上交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、关于公司本次向特定对象发行股票的主要安排

1、本次发行已经由 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十四次会议、2026 年 5 月 14 日公司召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

2、本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，经中国证监会作出同意注册后，与主承销商按照相关法律、法规及规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（即“发行底价”）。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

最终发行价格由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，经中国证监会作出同意注册后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定，但不低于前述发行底价。

若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则本次发行的发行底价按照上海证券交易所的相关规则相应调整。

4、发行数量：本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行的股票数量不超过28,514,826股（含本数）。

最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。

在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

5、本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过138,297.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		项目投资总额	募集资金使用额
1	高密度光互联产品生产建设项目	杰普特高密度光互联产品生产基地建设项目	75,218.80	67,304.00
		杰普特高密度光互联产品生产线建设项目	10,856.20	9,256.00
		小计	86,075.00	76,560.00
2	杰普特总部及研发中心升级建设项目		24,713.00	21,737.00
3	补充流动资金		40,000.00	40,000.00
合计			150,788.00	138,297.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募

集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

6、发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象基于本次发行所得股份因公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。

7、本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

8、本次发行相关决议的有效期为公司股东会审议通过之日起 12 个月。

9、公司本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

10、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）等相关法律、法规的要求，为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，公司进一步完善了股利分配政策并制定了未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划。

11、本次向特定对象发行股票完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间，因此本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。详见本募集说明书“第七章 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”。

公司所制定的填补回报措施不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成承诺，不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

二、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本募集说明书“第六章 与本次发行相关的风险因素”的全部内容，注意投资风险：

（一）募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目是公司基于行业发展趋势、市场容量、客户需求以及公司未来产能布局、经营状况和技术储备等充分调研的基础上，经审慎论证后确定的，具有较强的可行性和必要性，项目实施有利于公司业务发展并符合公司的发展战略。公司基于历史数据、未来行业和公司的发展趋势对本次募投项目的资金投入和预计效益进行了合理测算，但在募投项目的实施过程中，公司将可能会受到市场环境变化、行业增速放缓、技术路径变更、原材料价格波动等不确定或不可控因素的影响，本次募集资金投资项目存在不能完全实现预期目标或效益的风险。

（二）募投产能消化风险

本次募集资金投资项目已经经过充分的可行性分析论证，但从产能消化角度，如果未来下游 AI 行业、数据中心市场发展不及预期，或者产品技术迭代加快、行业竞争加剧导致本次募投项目相关产品的市场需求大幅减弱，以及公司与境外重要客户的合作可能受贸易政策、地缘政治等因素的影响导致中断，将导致募投项目产能不能按预期充分消化的情形，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（三）募集资金投资项目实际效益不及预期的风险

公司本次募投项目预计达到的效益是综合考虑当前经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力和产品竞争力等因素做出的测算，公司经过审慎分析后认为本次募投项目将实现良好的经济效益。但是考虑未来的经济形势、行业发展趋势、市场竞争环境等存在不确定性，以及募投项目在实施过程中可能会面临成本增加、进度延迟和市场需求变化等方面的风险，因此存在募集资金投资项目实际效益不及预期的风险。

（四）市场竞争风险

公司的产品在国内外均有一定数量的竞争对手，存在部分竞争对手采用低价竞争等策略激化市场竞争态势，对公司产品的销售收入和利润率产生了负面影响。随着激光器

市场竞争的进一步加剧，公司激光器的平均毛利率将可能出现一定幅度的下降，将可能导致利润总额出现大的降幅。

（五）新业务新产品市场拓展风险

公司在光连接/光通信、PCB 制造、绿色能源、VR/AR 等新领域持续开发新技术新产品，公司存在在上述新领域随着行业竞争加剧导致业务拓展不理想的风险。

（六）市场或行业政策变化风险

公司业务的下行业较为集中，其中人工智能、消费电子、半导体、绿色能源等行业与国家的产业经济政策密切相关。公司存在因国家产业政策调整或宏观经济出现周期性波动等因素导致下游产业发展不达预期，而使公司业务增长速度放缓，甚至业绩下降的风险。

（七）国际贸易环境不稳定的风险

近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护措施，我国部分产业发展受到一定冲击。集成电路和半导体行业具有典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对集成电路和半导体产业链上下游公司的生产经营产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而可能对公司的经营带来不利影响。

（八）客户集中度较高和激光/光学智能装备业务存在大客户依赖的风险

报告期各期，公司前五大客户销售额分别为 38,787.41 万元、56,320.91 万元、91,815.24 万元、38,691.33 万元，占公司营业收入的比例分别为 31.65%、38.74%、44.27%、58.55%。由于下游行业竞争激烈，以及宏观经济波动、技术更新换代等因素导致大客户需求不断变化提升，如果大客户未来因选择其他供应商等原因减少对公司产品的采购量，可能会对公司整体业务的销售收入、毛利率和净利润等指标构成较大不利影响。

（九）海外销售的风险

公司境外收入是公司重要的收入和利润来源，未来一段时间内对海外市场尤其是欧洲、美国、中国台湾地区市场的销售额仍然较高。报告期各期，公司境外销售额分别为 23,085.03 万元、20,943.16 万元、35,735.71 万元、21,809.91 万元，占公司营业收入的比

例分别为 18.85%、14.41%、17.24%、33.03%。公司存在因海外市场发生较大波动或产品主要进口国家及地区政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化，而导致公司海外销售收入下降的风险。

（十）部分原材料境外采购的风险

报告期内，公司境外采购（含向境外厂商或其在国内的代理商）原材料的采购金额占原材料采购总额的比重高。未来一段时间内公司将继续从欧洲、美国、日本等境外国家和地区采购原材料，受近期国际贸易局势影响，公司存在因原材料出口国贸易政策发生不利变化进而影响公司的业务发展的风险。

（十一）汇率波动风险

近年来，公司产品销售收入中外销收入比重较高，公司境外销售通常以美元、新加坡元为主进行定价和结算，人民币汇率波动会对公司收入和汇兑损益产生影响，从而对公司经营业绩带来一定程度的不确定性。

（十二）应收账款违约及周转率下降的风险

公司 2023 年末、2024 年末、2025 年末、2026 年 3 月末的应收账款净额分别为 36,836.44 万元、50,689.76 万元、52,805.90 万元和 61,864.89 万元，占流动资产的比重分别为 21.10%、26.94%、21.63%和 23.14%，应收账款净额较大，公司存在因客户应收账款违约（包括客户故意拖欠应付款项、客户经营业绩不佳无力清偿情况等）而导致公司款项无法收回、产生坏账损失的风险。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、关于公司本次向特定对象发行股票的主要安排.....	2
二、特别风险提示.....	5
目 录	8
释 义	10
第一章 发行人基本情况	14
一、发行人基本信息.....	14
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	14
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	15
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	25
五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.....	32
六、现有业务发展安排及未来发展战略.....	35
七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....	36
八、本次发行不存在违法行为、资本市场失信惩戒相关情形.....	42
第二章 本次证券发行概要	43
一、本次发行的背景和目的.....	43
二、发行对象及与发行人的关系.....	47
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....	47
四、募集资金金额及投向.....	48
五、本次发行是否构成关联交易.....	49
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	49
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	50
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	51
一、本次募集资金使用计划.....	51
二、本次募集资金投资项目的的基本情况.....	51
三、项目土地、备案及其他相关手续进展情况.....	61
四、募集资金用于扩大既有业务、拓展新业务的情形.....	62

五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....	64
六、募集资金用于研发投入的情况.....	65
七、本次募集资金投资属于科技创新领域.....	66
八、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响.....	67
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	68
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....	68
二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化.....	68
三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....	68
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	69
五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....	69
第五章 最近五年内募集资金使用情况	70
第六章 本次发行相关的风险因素	71
一、本次向特定对象发行 A 股相关风险.....	71
二、技术风险.....	71
三、经营风险.....	72
四、财务风险.....	74
五、募集资金投资项目风险.....	75
六、募投产能消化风险.....	75
七、募集资金投资项目实际效益不及预期的风险.....	75
八、人才流失风险.....	75
第七章 与本次发行相关的声明	77
一、发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明.....	77
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	80
三、保荐人声明.....	81
四、发行人律师声明.....	84
五、会计师事务所声明.....	85
六、发行人董事会声明.....	86

释 义

在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般用语		
募集说明书、本募集说明书	指	《深圳市杰普特光电股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》
A股	指	在上交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
本次向特定对象发行股票/本次向特定对象发行/本次发行	指	深圳市杰普特光电股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的行为
公司/本公司/发行人/上市公司/杰普特	指	深圳市杰普特光电股份有限公司
同聚同源	指	厦门市同聚同源咨询管理合伙企业（有限合伙）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
董事会	指	深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
股东会	指	深圳市杰普特光电股份有限公司股东会
报告期、本报告期	指	2023年1月1日至2026年3月31日
报告期末	指	2026年3月31日
《公司章程》	指	《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》
定价基准日	指	计算发行底价的基准日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业用语		
激光	指	由粒子受激辐射产生的光束，具有良好的单色性、相干性、方向性和高能量密度的特点，广泛应用于各种工业制造领域
激光器、激光光源	指	产生、输出激光的器件，是激光及其技术应用的基础，是激光加工系统的核心器件
激光/光学智能装备	指	具有感知、分析、推理、决策、控制功能的激光/光学装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合
光纤激光器	指	用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器，具有电光转换效率高、高可靠性、结构简单等优点
固体激光器	指	用固体材料作为工作物质的激光器
MOPA	指	Master Oscillator Power - Amplifier，主控振荡器的功率放大器

脉冲激光	指	按一定频率输出激光的工作方式，一般具有较大的峰值输出功率
MOPA 脉冲光纤激光器	指	采用 MOPA 结构方案的光纤激光器，该类型的激光器输出的激光脉冲宽度可以根据用户的使用要求进行灵活调节
脉冲光纤激光器	指	输出为脉冲形式激光的光纤激光器
连续光纤激光器	指	输出为连续形式激光的光纤激光器
激光焊接	指	由计算机控制激光辐射加热工件表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光功率等参数，使金属工件熔化接合
激光打标	指	由计算机控制激光的聚焦及运动，使焦点在物体表面快速移动轨迹，从而在物体表面刻蚀出图形、文字等信息标记，以达到印刷目的
激光钻孔、激光蚀刻	指	由激光加工设备输出受控高频脉冲激光束聚焦在加工材料表面，形成细微高能量密度光斑，以高温熔化或气化被加工材料，对加工材料形成钻孔或蚀刻的工艺效果
精密加工	指	加工精度在 0.1-10 微米、表面粗糙度（Ra 值）在 0.3-0.8 微米的加工
激光切割	指	由计算机控制激光器放电，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光功率等参数，对加工材料形成切割的工艺效果
激光清洗	指	由计算机控制激光输出参数，利用具有高能量密度的激光光束与需要去除的材料表面相互作用，保证不损伤基底材料的同时去除涂覆层，完成对材料的清洗
增材制造、3D 打印	指	采用材料逐渐累加的方法制造实体零件的技术，相对于传统的材料“去除一切削”加工方法，它是一种“自下而上”的制造方法
光通信	指	以激光为传播媒质的通信方式，具有传输频带宽、通信容量大和抗电磁干扰能力强等优点
毫秒（ms）、微秒（μs）、纳秒（nm）、皮秒（ps）、飞秒（fs）	指	均为时间单位，其中 1 毫秒=10 ⁻³ 秒，1 微秒=10 ⁻⁶ 秒，1 纳秒=10 ⁻⁹ 秒，1 皮秒=10 ⁻¹² 秒，1 飞秒=10 ⁻¹⁵ 秒
mW、W、kW	指	毫瓦、瓦、千瓦，电功率和光功率单位
MPO	指	Multi-Fiber Push On，多芯光纤推挽式连接器，是一种在高速数据传输和高密度布线场景中广泛应用的光纤组件
MMC	指	Mini-Multi-Connector，微型多芯连接器，是一种超小型（VSFF）高密度多芯光纤连接器
FAU	指	Fiber Array Unit，光纤阵列单元，通过将多根光纤以微米级精度排列固定，实现多路光信号的高效耦合与稳定传输
PCB	指	Printed Circuit Board、印制电路板，是指在绝缘基材上，按预定设计形成点到点间连接导线及印制组件的印制板，其在电子设备中起到支撑、互连部分电路组件的作用
AI	指	人工智能，Artificial Intelligence，研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新技术科学
CPO	指	Co-Packaged Optics，光电共封装将传统独立的光模块与交换/GPU 芯片深度集成
电感	指	用（绝缘）导线绕制成一定圈数的线圈，线圈内插入磁性材料所构成的电气元件。其电感量为线圈通电后内部所形成的磁通变化量与流经线圈的电流变化量之比
机器视觉	指	人工智能发展的一个分支，用机器代替人眼来做测量和判断

电池片	指	利用太阳光直接发电的光电半导体薄片
钙钛矿	指	钙钛矿型太阳能电池（Perovskite Solar Cell），是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池
畸变	指	光学系统对物体所成的像相对于物体本身而言的失真程度，光学畸变是指光学理论上计算所得到的变形度
调 Q	指	通过某调节激光腔的损耗，改变腔内 Q 值（即品质因子）的技术。在低 Q 值状态，阈值较高，上能级的反转粒子数就可以大量积累，当积累到最大值（饱和值）时，Q 值突增，形成激光震荡，获得峰值功率很高的巨脉冲输出
脉宽	指	激光功率维持在一定值时所持续的时间
耦合	指	输入与输出之间存在紧密配合与相互影响，并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象
相干性	指	为了产生显著的干涉现象，波所需具备的性质。更广义描述波与自身波或与其它波之间对于某种内秉物理量的关联性质
鬼影	指	光线进入光学镜头内部，因为镜片、结构件等元件存在反射导致拍摄画面出现与光源像点相似的其他像点的现象
被动元器件	指	不影响信号基本特征，仅令讯号通过而未加以更改的电路元件，又称为无源元件，最常见的是电容、电感、电阻、晶振、变压器等
泵浦源	指	通过提供能量以在不同能级间实现工作物质中粒子数反转分布的装置
XR	指	扩展现实（Extended Reality），是指通过计算机将真实与虚拟相结合，打造一个可人机交互的虚拟环境，这也是 AR、VR、MR 等多种技术的统称
A 公司	指	Apple Inc.及其下属企业
Meta	指	Meta Platforms Inc.及其下属企业
英特尔	指	Integrated Electronics Corporation 及其下属企业
国巨股份	指	国巨股份有限公司及其下属企业
厚声电子	指	厚声电子工业有限公司及其下属企业
意法半导体	指	意法半导体（ST）集团（ST Microelectronics）
顺络电子	指	深圳顺络电子股份有限公司及其下属企业
东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司及其下属企业
胜宏科技	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司及其下属企业
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属企业
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司及其下属企业
国轩高科	指	国轩高科股份有限公司及其下属企业
科达利	指	深圳市科达利实业股份有限公司及其下属企业
MR/AR	指	混合现实（Mixed Reality），增强现实（Augmented Reality）
VCSEL	指	Vertical Cavity Surface Emitting Laser，是一种出光方向垂直于谐振腔表面的发射激光器
CAD	指	计算机辅助设计（Computer-Aided Design），用于使用计算机技术进行设计和设计文档化，与 CAM 共同在工程、制造

		和产品设计领域中使用
CAM	指	计算机辅助制造（Computer-Aided Manufacturing），用于使用计算机软件和硬件控制制造过程，与 CAD 共同在工程、制造和产品设计领域中使用
3C	指	计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三类产品，亦称“信息家电”

本募集说明书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是因四舍五入造成的。

第一章 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	深圳市杰普特光电股份有限公司
英文名称	ShenZhen JPT Opto-electronics Co., LTD.
注册地址	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 A 栋 1201
办公地址	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 A 栋 1201
股票上市地	上海证券交易所
股票代码	688025.SH
中文简称	杰普特
成立时间	2006 年 4 月 18 日
法定代表人	黄治家
注册资本	9,504.9423 万元人民币
董事会秘书	吴检柯
联系电话	0755-29528181
公司传真	0755-29529195
公司网址	www.jptoe.com
经营范围	光电子元器件、激光器、测量设备、激光加工设备、自动化装备的技术开发和销售；普通货运；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。光电子元器件、激光器、测量设备、激光加工设备、自动化装备的生产。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）前十名股东情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	黄治家	18,275,464	19.23
2	厦门市同聚同源咨询管理合伙企业（有限合伙）	12,477,042	13.13
3	全国社保基金五零三组合	3,800,000	4.00
4	蒋仕波	2,758,498	2.90
5	刘健	2,590,198	2.73

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
6	黄淮	2,520,648	2.65
7	高雅萍	1,604,184	1.69
8	香港中央结算有限公司	1,229,539	1.29
9	中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	1,196,401	1.26
10	中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	1,171,878	1.23
合计		47,623,852	50.11

（二）控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书签署日，公司总股本为 95,049,423 股。发行人的控股股东、实际控制人为自然人黄治家，直接持有发行人 18,275,464 股，占公司总股本的 19.23%，并通过其担任执行事务合伙人的同聚同源控制公司 12,477,042 股股份，占公司总股本的 13.13%。此外，黄治家一致行动人黄淮直接持有发行人 2,520,648 股股份，占公司总股本的 2.65%。因此，黄治家直接或间接控制公司 35.01%的股份。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）行业管理体制及政策法规

1、行政主管部门和监管体系

公司所处行业主管部门为工信部，行业内部自律性管理组织为中国光学学会。

工信部的职责是负责拟订工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施；进行高技术产业中涉及高端制造、新材料等的规划、政策和标准的拟订及组织实施以及工业日常运行监测等。

中国光学学会是我国光学与光学工程等领域科技工作者的民间学术团体，以团结国内外科学家为光学与光学工程等领域推动与实现科技发展为宗旨。学会围绕光学及光学工程科技领域开展以下主要业务活动：（1）开展国内外学术交流及科技交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；（2）鼓励并组织科学技术工作者为建立以企

业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；（3）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；（4）举荐科学技术人才，依照有关规定经批准表彰奖励优秀科学技术工作者；（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果评价，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；（6）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往等。

2、行业主要法律法规和政策

（1）行业主要法律法规

公司所处行业主要法律法规涉及产品质量、环境保护、安全生产、知识产权等方面，主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国商标法》等。

（2）行业相关产业政策

激光产业是国家长期重点支持发展的产业，《战略性新兴产业分类（2018）》将各类激光器和激光精密加工设备列入指导目录，近年来国家相关部门出台了一系列政策支持该产业的发展，主要如下：

时间	部门	产业政策	相关内容
2024年	工信部	《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》	电子元器件和电子材料行业：重点推动高效晶体生长炉、气相沉积设备、自动粉碎机、喷雾干燥机、烧结炉、辅助机加设备等电子功能材料专用生产设备；曝光设备、显影设备、蚀刻设备、研磨抛光设备、电化学沉积设备、激光打孔、印刷设备、焊接设备等封装与装联材料专用生产设备。
2024年	工信部、教育部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	前瞻部署新赛道：未来制造。发展智能制造、生物制造、纳米制造、激光制造、循环制造，突破智能控制、智能传感、模拟仿真等关键核心技术，推广柔性制造、共享制造等模式，推动工业互联网、工业元宇宙等发展。
2023年	财政部、工信部	《制造业可靠性提升实施意见》	实施基础产品可靠性“筑基”，重点提升大功率激光器等重点基础零部件的可靠性水平；实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，重点提升激光焊接和切割设备等工业制造母机的可靠性水平。
2022年	生态环境部、发改委、工信部	《工业领域碳达峰实施方案》	围绕高端装备等战略性新兴产业,打造低碳转型效果明显的先进制造业集群；到2025年，激光热处理等先进近净成形工艺技术实现产业化应用。
2022年	工信部、发改委等六部门	《工业能效提升行动计划》	推进重点行业节能提效改造升级。加快一体化压铸成形、无模铸造、超高强钢热成形、精密冷锻、异质材料焊接、

时间	部门	产业政策	相关内容
			轻质高强合金轻量化、激光热处理等先进成形工艺技术产业化应用。
2021年	发改委、工信部等八部委	《“十四五”智能制造发展规划》	规划指出大力发展智能制造装备。通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。通过智能装备包括：激光/电子束高效选区熔化装备、激光选区烧结成形装备等增材制造装备；超快激光等先进激光加工装备。
2021年	工信部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	重点发展高速光通信芯片，高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器等。
2020年	科技部、国家发改委、教育部、中国科学院、自然科学基金委	《加强“从0到1”基础研究工作方案》	面向国家重大需求，对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持。重点支持人工智能、网络协同制造、3D打印和激光制造、重点基础材料、先进电子材料、结构与功能材料、制造技术与关键部件、云计算和大数据、高性能计算、宽带通信和新型网络、地球观测与导航、光电子器件及集成、生物育种、高端医疗器械、集成电路和微波器件、重大科学仪器设备等重大领域，推动关键核心技术突破。

3、行业政策影响分析

上述行业管理部门负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其他宏观调控措施，对行业发展起到规划、监控等宏观调控作用，有助于行业健康有序发展，为公司经营发展提供良好的外部环境。

（二）行业基本情况

公司主营业务为研发、生产和销售激光器、主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备以及光通信领域光纤器件，公司主要产品包括激光器、激光/光学智能装备和光纤器件。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于制造业（C）—计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

公司所从事的激光器、激光/光学智能装备和光纤器件业务，属于新一代信息技术、新材料与高端装备制造相融合的高新技术与战略性新兴产业，是支撑制造业转型升级的关键技术之一。

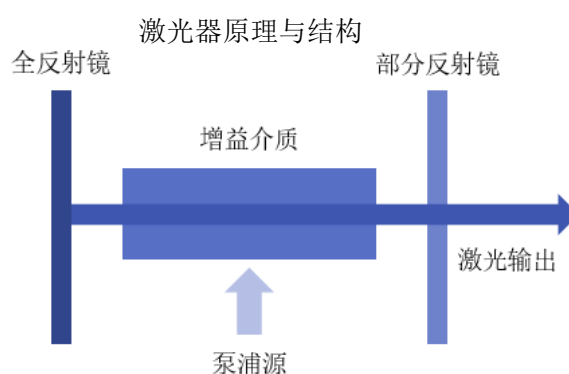
1、激光器行业概况

（1）激光器简介

激光是指特定的物质受到外部强能量激发而产生的光。相较于其他类型的光，激光

具有发散度小、亮度高、单色性好、相干性好等一系列特点，因此被广泛地运用于工业制造、信息通讯、生物医药、科研军事等诸多领域，并在社会生产活动中发挥了极其重要的作用，激光也因此与计算机、原子能和半导体并称二十世纪的新四大发明。

激光器是激光的发生装置，主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源是激光器的能量供给来源；增益介质是激光器的核心，会吸收泵浦源提供的能量并将激光放大；谐振腔是两面互相平行的镜子，其作用是把光线在反射镜间来回反射并多次经过增益介质，因而在缩短工作物质长度的同时还能达到放大激光功率的目的。



（2）激光器分类

激光器可以按照增益介质、输出功率、工作方式、泵浦方式和输出波长等不同维度进行分类，具体分类方式如下所示：

1) 按照增益介质的不同，可以分为液体激光器、气体激光器和固体激光器（光纤、半导体、全固态、混合），其中光纤激光器由于增益介质较为特殊且占有较高的市场份额，学术及生产实践中一般会将其与其他固体激光器单独区分开。目前发现可做增益介质的物质有近千种，常见的有掺稀土元素光纤、染料、惰性气体、二氧化碳、掺钕钇铝石榴石（YAG）和钛蓝宝石等。每类增益介质激光器具有不同的特点，不同的增益介质决定了激光波长等参数。

2) 按照输出功率的不同，分为低功率（0-100W）、中功率（100-1,000W）、高功率（1,000W 以上）；不同功率的激光器适应的应用场景不同。

3) 按工作方式的不同，激光器可分为连续激光器和脉冲激光器。连续激光器可以在较长一段时间内连续输出，热效应高。脉冲激光器以脉冲形式输出，主要特点是峰值功率高，热效应小；根据脉冲时间长短，脉冲激光器可进一步分为长脉冲（毫秒、微秒）、短脉冲（纳秒）、超短脉冲（皮秒、飞秒）激光器，一般而言，脉冲宽度越窄、波长越

短，可实现的加工精度越高。

4) 按泵浦方式的不同，激光器主要可以分为光泵浦激光器、电泵浦激光器、化学泵浦激光器、热泵浦激光器和核泵浦激光器。一般而言，不同类型的泵浦源是与激光晶体不同的吸收波长相适应的。

5) 按输出波长的不同，激光器可分为红外激光器、可见光激光器、紫外激光器等。不同结构的物质可吸收的光波长范围不同，因此需要各个波长的激光器应用于不同材料的精细加工。

近年来，中国激光器市场规模一直保持增长趋势。根据中商产业研究院发布的《2025-2030 年中国激光器市场前景及投资机会研究报告》显示，2023 年中国激光器市场规模达到 1,210 亿元，同比增长 16.68%，2024 年约为 1,353 亿元，2025 年中国激光器市场规模将达 1,450 亿元。



2、激光/光学智能装备行业概况

激光/光学装备主要由光学系统、机械系统和数控系统组成，按功能划分主要包括激光焊接、激光打标、激光切割、激光钻孔、激光蚀刻、激光清洗、增材制造和用于各类特殊材料加工的行业专用设备。激光/光学装备的应用领域非常广泛，主要包括材料加工与检测、通信、科研和军事、医疗和美容、仪器仪表和传感器、光学存储、显示、打印等领域。

近年来，全球电子、微电子、光电子、通讯、光机电一体化系统等行业的发展，带动了全球激光加工设备制造行业的迅速发展，同时我国新能源汽车、半导体和电子制造产业的发展，使得国内激光加工设备市场保持快速增长。根据中国光学学会编写的《2026中国激光产业发展报告》，2025年全球激光设备市场销售收入约为224.9亿美元，同比增长2.9%，中国激光设备市场销售收入为958亿元，同比增长6.8%，销售收入占全球市场比例提高至58%。预计2026年我国激光设备市场销售收入增长率维持7%左右，将达到1,025亿元。在宏观经济发展、产业升级、国家政策支持等多重因素的影响下，国产激光器及智能激光设备在性能、价格、服务等多方面逐步优于进口激光器、进口激光加工设备，未来几年激光器、激光加工设备国产替代率将持续提高。

3、光纤器件产品行业概况

光器件作为光通信网络的基础核心元器件，也是数据中心内部实现数据传输的关键构成部件，主要承担光信号生成、调制探测、收发传输、光路衔接、波分复用与解复用、光路转换、信号放大及光电转换等核心功能。根据是否依赖外部能源驱动，光器件可划分为有源光器件和无源光器件。其中有源光器件主要承担光信号生成、电信号与光信号之间转换、以及光信号的发射和接收等工作；无源光器件则承担光信号光路连接、传输调控、相干处理、光路隔离、过滤等管控职能，为光信号传输系统搭建关键节点。发行人主营的光纤器件产品属于无源光器件，主要应用于光模块及通信设备内，应用场景面向全球数据中心与电信领域，与AI算力建设、数据中心产业链有高度关联性。

2025年以来，受益于AI算力和数据中心需求快速增长，光通信市场景气度持续提升，全球各大云服务商及超大规模数据中心运营商不断上调资本开支计划。据Bloomberg数据，2026年Meta、谷歌、亚马逊和微软等四家公司的合计资本开支预计达6,300-6,700亿美元，同比增长约70%。2026年中国算力基建投入达到5,000亿元人民币水平。根据

国际数据公司(IDC)与浪潮信息联合发布《2025 年中国人工智能算力发展评估报告》，2024 年全球人工智能服务器市场规模为 1,251 亿美元，2025 年将增至 1,587 亿美元，2028 年有望达到 2,227 亿美元。同时，随着 CPO 技术逐步进入规模化商用阶段，单台 CPO 交换机可承载和输出的光纤通道数较传统方案将显著增加，相应将对关键光纤器件提出高密度的配置需求，以及更复杂的性能要求，以支持各端口光纤通道的高效稳定连接。在上述因素驱动下，光通信市场需求快速增长，光连接模块及光器件作为光通信领域的关键基础组件相应迎来发展机遇，根据 LightCounting 测算，2026 年全球光模块数通市场 228 亿美元，至 2030 年复合增速为 20%；2026 年全球光模块电信市场 53 亿美元，至 2030 年复合增速为 7%。

（三）发行人所处行业的竞争情况

1、行业市场总体竞争格局

（1）激光器及激光/光学智能装备行业市场竞争情况

从国际来看，欧美等发达国家作为传统的激光技术强国，最先在工业生产领域大规模使用激光设备，因而在较长时间内是全球激光设备市场上的主要需求方，也培育出了德国通快、美国相干、IPG 等长期占据全球激光器市场绝大部分份额的国际巨头；但近年来，随着广大发展中国家制造业的转型升级，其高端工业领域对激光设备的需求激增，其本土的激光器和激光设备产业链得到了迅速发展和壮大。

整体上看，发展中国家自主研发生产的中、低端激光器和激光设备在性能上已基本可以与上述国际巨头相抗衡，再凭借地域距离、产品性价比、售后服务等多重优势，已逐步打破欧美巨头的垄断格局，在中低端市场开始占据主导地位。在高端激光器和激光设备生产上，与欧美发达国家逐渐缩小并在部分产品上已实现超越。其中，高功率激光器国产化率持续提升，2025 年 10kW 以上产品国产化率已接近 80%；中国光纤激光器用特种光纤市场销售收入 19.5 亿元，同比增长 17%。

国内来看，我国激光设备产业呈现出较为明显的聚集性特征，目前已经形成了珠三角、长三角、华中地区和环渤海地区四大产业集群，珠三角以中小功率激光加工机为主，代表性企业有大族激光、英诺激光、海目星、杰普特、光韵达、联赢激光等；长三角涵盖了大功率激光切割焊接设备及精细微加工设备，代表性企业如德龙激光、亚威股份等；环渤海以大功率激光熔覆和全固态激光器为主，代表性企业如凯普林、国科世纪、邦德

激光等；华中地区则较为全面地覆盖了大、中、小各类激光加工设备，代表性企业有华工科技、锐科激光、帝尔激光、华日激光等。

（2）光纤器件行业市场竞争情况

当前国内光通信无源光纤器件行业呈现分层竞争格局，整体形成海外厂商把控高端市场、国内头部企业占据主流中高端领域、中小厂商进行低端市场价格竞争的格局。以天孚通信、长芯博创等为代表的国内头部企业，深耕光纤器件领域多年，产品工艺、良率及综合性能处于行业领先水平，同时完成了全球主流云厂商、大型光模块企业的供应链认证，客户结构优质且合作稳定，在高端市场具备较强定价权。随着 AI 算力基础设施建设推进与光模块高速化升级，行业迎来高速增长周期，增量市场空间广阔，为各梯队企业均提供了重要发展机遇。

依托本轮行业发展契机，通过持续拓展海内外市场渠道、技术及产品不断优化、迅速提升制造与交付能力，第二梯队企业有望迅速跻身行业头部、提升市场份额。伴随行业向 800G、1.6T 等高速方向升级，低端市场内中小厂商则受产品附加值低、竞争激烈影响，盈利空间持续压缩，行业集中度将进一步提升。在当前行业竞争模式下，技术实力、客户认证能力与规模化制造水平将成为决定企业市场地位的核心因素。

2、公司竞争优势以及行业地位

经过十余年的科研积累和业务发展，公司搭建了国际化的研发营销平台，积累了丰富的专利技术、研发经验和客户资源，赢得了一定的市场占有率和品牌知名度，成为中国首家商业化批量生产 MOPA 脉冲光纤激光器的厂商。公司的激光器产品品类丰富，包含 MOPA 脉冲激光器、连续光激光器、固体激光器和超快激光器等。2025 年，公司激光器系列产品受益于全球范围内激光器需求提升，在新能源动力电池精密加工及消费级激光器领域实现销售收入的较快增长，公司激光器产品销售额较去年同期增长 44.49%。其中，在动力电池领域，公司持续配合客户在新工艺、新技术上的优化改进，2025 年公司服务的动力电池行业头部客户扩产需求旺盛；在消费级激光器领域，公司自研的光纤激光器在加工材料的适配性及加工效率方面具有显著提升，应用于消费级激光雕刻机的激光器产品已获得客户批量订单。目前公司配合行业内多家客户在激光器产品验证，预计未来将会有更多新增客户方面的突破。

行业发展早期，在激光/光学智能装备领域，激光精密检测和微加工智能装备产品

主要被少数几家国际知名公司垄断，国内进入厂家相对较少。公司基于客户需求和自身在激光光源领域的技术积淀，以及差异化竞争策略，成功研发出智能光谱检测机和激光调阻机。基于上述两款产品公司进入到 A 公司的产品供应链与被动元器件行业，根据对于客户以及行业的需求公司进行新产品研发拓展。

公司研发的智能光谱检测机于 2014 年进入 A 公司供应链，订单快速增长。基于公司产品优良的检测效率，客户进一步提出更多定制化设备需求，公司近年陆续为客户提供玻璃面板二维码标刻设备、VCSEL 模组检测设备、VR 眼镜检测系统等多款激光/光学智能装备，公司预计未来将与该客户在各个细分领域保持紧密的合作关系。

公司掌握了激光调阻机高精度的量测技术和激光光源技术，生产的激光调阻机系列产品自 2015 年以来陆续服务于风华高科、顺络电子、国巨股份、厚声电子、乾坤科技、华新科技等知名被动元器件厂家。

近年大部分被动元器件行业加工设备主要仍由海外设备厂商垄断，公司在 2021 年布局扩展被动元器件行业自动化设备品类。公司以自主研发、合资设立控股公司、参投公司等方式研发了电感剥漆设备、电感绕线设备、测包机以及电容测试分选机等产品。2025 年电容测试分选机已开始获得国内行业同步客户订单，目前客户对该产品满意度较高，逐步开始实现该产品国产替代。

在 PCB 生产领域，公司研发出用于柔性电路板打通孔与打盲孔的 FPCB 激光钻孔机，该产品已开始获得客户订单，未来有望逐步替代进口设备，助力公司营收增长。

2025 年，公司在光连接/光通信领域加速布局，持续聚焦未来光连接解决方案，面对数据中心、云计算、人工智能行业的旺盛需求，推出了 MPO/MMC 光纤连接器、光纤阵列单元（FAU）等产品。目前市场对于 MPO 需求增长较快，公司积极布局产能以满足客户需求。根据目前行业发展态势，公司布局 FAU 产线扩产以及产线自动化程度提升，预计上述布局能够为公司在未来 FAU 市场需求增加时保持竞争优势。

3、行业主要竞争对手

在激光器以及激光加工设备细分领域中，重点企业包括 IPG Photonics Corporation、美国相干、德国通快等国外知名激光加工设备公司，亦包括大族激光、锐科激光、精测电子、长川科技等国内知名激光加工设备公司。公司聚焦于半导体及光学、显示、消费电子及科研领域的定制化精密激光加工设备的研发、生产和销售，在上述领域与国际厂

商和国内大厂进行竞争，获得客户的认可。在光纤器件产品细分领域，主要可比公司有天孚通信、长芯博创、仕佳光子等光通信行业知名企业。国内上市公司中尚无与杰普特激光核心技术和主要产品完全重叠的企业，公司按照业务形态、主要产品、应用领域、客户结构等标准，选取大族激光、锐科激光等具有相似性的企业进行比较。各企业具体信息如下所示：

业务类型	公司性质	公司名称	基本情况
激光器	国外企业	IPG Photonics Corporation	IPG 于 1990 年开始运营，1998 年于美国特拉华州成立公司，为美国纳斯达克股票市场上市公司，股票代码 IPGP。主要产品为高、中、低功率光纤激光器及放大器，广泛应用于材料加工、光通讯、医学及科研等领域，业务覆盖全球主要市场。在美国、德国等地设有生产基地，并在中国、日本等地设有销售机构。
		nLIGHT Corporation	nLIGHT 设立于 2000 年，总部位于美国，为美国纳斯达克股票市场上市公司，股票代码 LASR，主要产品为半导体激光器、光纤激光器、光纤等。在中国设有恩耐激光技术（上海）有限公司，主要从事开发、生产和销售高功率半导体激光器，并为中国客户提供售后服务。
		美国相干（Coherent Corp.）	Coherent Corp. 于 1971 年在宾夕法尼亚州注册成立。Coherent 是材料、网络和激光器领域的全球领导者，是一家垂直整合的制造公司，开发、制造和销售工程材料、光电子元件和器件，以及用于工业、通信、电子和仪器仪表市场的激光器。
	国内企业	锐科激光	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司成立于 2007 年，2018 年在创业板上市（股票代码：300747），主要产品为脉冲光纤激光器、连续光纤激光器两大系列，主要用于激光制造如打标、切割、焊接、增材制造和激光医疗等多种工业、医疗和科研领域。
激光/光学智能装备	国外企业	德国通快	德国通快总部位于德国迪琴根，创立于 1923 年，至今已具有 90 多年的机床生产历史，是全球工业生产机床和激光领域的市场及技术领导者之一。随着市场的发展，历经多次转型革新，德国通快已由创立之初的一家机械厂成长为在全球约有 13,500 名员工的大型跨国企业集团。
	国内企业	大族激光	大族激光科技产业集团股份有限公司，1996 年创立于中国深圳，公司于 2004 年在深圳证券交易所上市（股票代码：002008），致力于智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化能力，是全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商。
		精测电子	武汉精测电子集团股份有限公司创立于 2006 年，主营业务聚焦于半导体、显示及新能源三大核心领域检测系统的研发、生产与销售。精测电子于 2016 年 11 月 22 日在深交所创业板上市（股票代码：300567）。
		长川科技	杭州长川科技股份有限公司创立于 2008 年，主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括测试机、分选机、自动化设备及 AOI 光学检测设备等。长川科技于 2017 年 4 月 17 日在深交所创业板上市（股票代码：300604）。
光纤器件	国内企业	天孚通信	苏州天孚光通信股份有限公司创立于 2005 年，主营业务为高速光器件的研发、生产和销售，分为无源光器件整体解决方案业务和光电封装业务两大核心业务板块。天孚通信于 2015 年 2 月 17 日在深交所创业板上市（股票代码：300394）。
		长芯博创	长芯博创科技股份有限公司创立于 2003 年，专注于光通信领域，业务覆盖光电芯片、光电模组、集成光电子器件、光模块、有源光缆（AOC）、铜缆（DAC/ACC/AEC）、综合布线等产品及解决方案。长芯博创于

业务类型	公司性质	公司名称	基本情况
			2016年10月12日在深交所创业板上市（股票代码：300548）。
		仕佳光子	河南仕佳光子科技股份有限公司创立于2010年10月26日，聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。仕佳光子于2020年8月12日在上交所科创板上市（股票代码：688313）。

资料来源：主要竞争对手公告、官网介绍等公开资料。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）发行人的主营业务情况

公司主营业务为研发、生产和销售激光器、主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备以及光通信领域光纤器件。公司是中国首家商用“脉宽可调高功率脉冲光纤激光器（MOPA 脉冲光纤激光器）”生产制造商和领先的光电精密检测及激光加工智能装备提供商。

经过多年发展，公司以激光器研发为基础，打造激光与光学、测试与测量、运动控制与自动化、机器视觉等技术平台。目前公司已拥有一支以深圳和新加坡为中心的国际研发、销售团队，产品和服务覆盖亚洲、北美、欧洲等地区的众多知名客户。公司生产的各类核心激光器、激光/光学智能装备产品及光纤器件产品已获得 A 公司、Meta、英特尔、国巨股份、厚声电子、意法半导体、顺络电子以及宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、一汽弗迪等全球领先的消费电子、半导体、光电元器件及动力电池头部厂商的认可。

（二）发行人主要产品

公司主要产品包括激光器、激光/光学智能装备和光纤器件。公司的激光器产品包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等。公司是中国首家商用“脉宽可调高功率脉冲光纤激光器（MOPA 脉冲光纤激光器）”生产制造商和领先的光电精密检测及激光加工智能装备提供商，公司自主研发的脉冲可调（MOPA）脉冲光纤激光器获得了中华人民共和国工业和信息化部“制造业单项冠军产品”证书。

近年来，公司紧密围绕客户对激光技术解决方案的需求，开发了智能光谱检测机、激光调阻机、一体成型电感自动化加工检测设备、电容测试分选机、芯片激光标识追溯系统、激光划线机、VCSEL 激光模组检测系统等多款激光/光学智能装备，广泛应用于

激光精密加工、半导体光学检测、消费电子产品制造、贴片元器件制造等领域。

公司光纤器件产品主要包括光纤连接器、光缆组件、光纤阵列单元等。2025 年，围绕光连接/光通信应用领域，面向数据中心、云计算、人工智能行业的产业需求，公司开发了高密度光纤传输跳线 MPO（Multi-fiber Push On）、光纤阵列单元（FAU）及各类光纤组件产品。上述产品主要应用于数据中心中，作为数据在整个数据中心内传输的重要组成部分。

1、激光器

公司激光器产品主要包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等：

（1）脉冲光纤激光器

脉冲光纤激光器主要包括调 Q、锁模和 MOPA 等结构设计，公司的产品为 MOPA 结构，采用半导体激光器直接调制作为种子源，通过多级放大器实现对种子光源高功率放大，可根据用户实际需求分立调节激光器的脉冲宽度与输出频率。MOPA 脉冲光纤激光器作为重要的先进制造工具之一，比固定脉宽脉冲光纤激光器拥有更为广泛的应用场景。报告期内，公司生产的脉冲光纤激光器主要产品型号分为 M7 系列、CL 系列、M8 系列、GR 系列等，广泛应用于薄板或脆性材料切割、雕刻钻孔、激光清洗、玻璃切割/表面毛化、铜金属加工、3D 打印、光伏及锂电等加工场景。

21 世纪初，MOPA 脉冲光纤激光器由英国 SPI 公司率先推出并商用。公司成立之初即自主研发 MOPA 脉冲光纤激光器，并于 2010 年投入量产和销售，为首家国产商用 MOPA 脉冲光纤激光器生产制造商。目前公司在 MOPA 脉冲光纤激光器领域拥有多年的技术沉淀和大量优质的客户积累，技术与市场占有率均居国内领先水平。

（2）连续光纤激光器

连续光纤激光器是采用双包层有源光纤作为增益介质、光纤耦合输出半导体激光器作为泵浦源、光纤光栅作为谐振腔镜的激光器。公司产品采用全光纤结构，因而具有转换效率高、结构紧凑、光束质量好、免维护等优点。

报告期内，公司生产的连续光纤激光器主要产品有风冷连续光激光器、准连续激光器、单模连续光激光器、多模连续光激光器、AOB 复合光斑可调激光器等，可应用于

激光切割、焊接、打孔、3D 打印、锂电及汽车制造等不同场景。

提高光纤激光器输出功率，有两种路径，第一是提高单谐振腔输出功率，第二是采用多光路合束输出。报告期内，公司在售产品涵盖了 3,000W 及以下单模组连续光纤激光器和 60,000W 及以下多模组连续光纤激光器系列。目前公司正在研发更多模组的解决方案，可实现产品功率的快速提升，公司连续光纤激光器的技术整体处于国内先进水平。

（3）固体激光器

固体激光器适用于包括精密钻孔、切割、划槽等工艺在内的精细微加工领域，广泛应用于半导体、陶瓷、玻璃以及高分子材料的加工处理。

报告期内，公司生产的固体激光器种类包含水冷 Seal 系列、风冷 Lark 系列以及极紧凑型 Sparrow 系列，量产产品中紫外 355nm 功率范围覆盖 2W-30W，绿光 532nm 功率范围覆盖 2W-50W。

目前公司正在研发功率更高、脉宽更窄、体积更紧凑的固体激光器。借助于公司在激光器领域多年积累的客户资源以及产品本身的特点，公司固体激光器产品将进一步扩大市场及品牌影响力。

（4）超快激光器

超快激光器适用于蓝宝石、玻璃等脆性材料的切割、标记或开孔，也可应用于薄膜去除、PCB 板及金属微加工等应用领域。

公司生产的超快激光器采用紧凑型腔体设计与工业级电控架构，具备飞秒、皮秒级超短脉宽、极低热影响区等核心优势，产品覆盖红外、绿光、紫外等多波段输出，能够满足从微纳精密加工到前沿科研的高精度应用需求。

目前，公司全新推出的 JPT-LIT 飞秒激光器系列，采用创新性的被动空冷冷却方式，可确保关键光学参数的高度稳定，免维护的特性为更严苛的工业环境提供更高性能、更抗干扰的飞秒解决方案，适用于精密加工，支持多波长、可调脉宽及双波长输出，广泛应用于半导体、显示及精密微加工领域。

2、激光/光学智能装备

在激光/光学智能装备领域，激光精密检测和微加工智能装备产品主要被少数几家

国际知名公司垄断，国内进入厂家相对较少。公司基于客户需求和自身在激光光源领域的技术积淀，以及差异化竞争策略，成功研发出智能光谱检测机和激光调阻机。基于上述两款产品，公司进入到 A 公司的产品供应链与被动元器件行业，并根据客户以及行业的需求持续进行新产品研发拓展。在 PCB 生产领域，公司开发了用于柔性电路板打通孔与打盲孔的 FPCB 激光钻孔机，该产品已经客户验证实现销售，未来有望逐步替代进口设备，助力公司营收增长。

报告期内，公司生产的激光/光学智能装备主要产品有激光调阻机、一体成型电感自动化加工检测设备、电容测试分选机、芯片激光标识追溯系统、激光划线机、VCSEL 激光模组检测系统、硅光晶圆测试系统、MR 眼镜检测系统、摄像头模组测试校准设备、新能源动力电池激光焊接整体解决方案等多款激光/光学智能装备，广泛应用于激光精密加工、半导体光学检测、消费电子产品制造、贴片元器件制造等领域。

3、光纤器件

发行人光纤器件主要包括光纤连接器、光缆组件、光纤阵列单元等，主要应用于光纤通信领域，包括光纤到户、4G/5G 基站建设、数据中心和云计算等，主要客户包括康普通讯、中磊电子、中兴等知名客户。

报告期内，围绕光连接/光通信应用领域，面向数据中心、云计算、人工智能行业的产业需求，公司开发了 MPO/MMC 光纤连接器、光纤阵列单元 FAU 及各类光纤组件产品，相关产品主要应用于数据中心，作为数据在整个数据中心内传输的重要组成部件。

公司生产的高密度光纤连接器产品涵盖 MPO/MTP 主干光缆组件、分支跳线、MT 短跳线及 Fiber Array 阵列等，广泛应用于数据中心、高速光通信系统、通信基站、光模块等场景，具备低插损、高回损、高密度、小型化等特点，满足多芯连接、高速传输的严苛要求，支持多种端接类型和定制需求，以实现光互联高效部署。

光纤跳线系列产品涵盖 LC、SC、ST、FC、MU、MTRJ、E2000 等多种接口类型，广泛应用于数据中心、通信基站、CATV 系统和 FTTx 等光通信网络场景，产品支持单/多模、单双工配置，具备低插损、高回损、高稳定性等特点，满足不同布线长度、接口规格和系统集成需求，以实现高效、可靠的光纤互联。

发行人光纤器件主要产品如下：

产品名称	外形图	主要特点	应用领域
MPO/MTP 预端接主干光缆		1、插拔快速，便于施工操作； 2、布线密度高，可提供 12 至 144 芯光纤连接，节省布线空间； 3、低插损和高回损。	1、数据中心局域网； 2、PC 间数据平行交换应用； 3、10G/40G/100G/400G 网络传输； 4、光纤配线系统。
MPO/MTP 分支光纤跳线		1、连接主干缆输出端到配线架系统； 2、提供 4、8、12、16、24 芯多种分支规格可选； 3、可选分支连接类型包括 LC、SC、FC、ST 等。	1、数据中心互联； 2、高密度光纤管理； 3、电信网络和 CATV 网络； 4、O/E 模块互联。
光纤跳线		1、提供 UPC/APC 端面； 2、低插损和高回损； 3、提供单双工，单多模种类； 4、0.9/2.0/3.0 光缆直径备选； 5、连接头型号可选 LC/FC/SC/ST/E2000/MU 等。	1、光通信系统； 2、光测试设备； 3、CATV 系统； 4、长距传输通信系统； 5、局域网/本地网。
MT/FA/Jumper 光收发器产品组合		1、插拔快速，便于施工操作； 2、低插损和高回损； 3、符合 IEC-61754-7、Telcordia GR-468-CORE 和 RoHS 环保标准。	1、光模块、AOC、交换设备； 2、PC 间数据平行交换应用； 3、40G/100G/400G/800G 网络传输； 4、光纤配线系统。

4、主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入构成及占比如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
激光器	24,530.87	37.15%	101,306.58	48.87%	70,111.11	48.25%	66,542.19	54.33%
激光/光学智能装备	20,987.88	31.78%	72,955.25	35.19%	62,826.14	43.23%	43,622.97	35.62%
光纤器件	14,894.12	22.55%	14,303.93	6.90%	2,165.87	1.49%	2,210.43	1.80%
其他主营业务	5,627.16	8.52%	18,724.39	9.03%	10,211.87	7.03%	10,099.06	8.25%
主营业务收入	66,040.04	100.00%	207,290.15	100.00%	145,315.00	100.00%	122,474.64	100.00%

注：2023 年度、2024 年度、2025 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

（三）发行人的主要经营模式

1、采购模式

公司生产所需物料等由供应链管理中心集中采购。在原材料采购方面，公司基于生产计划并结合实际研发、生产需要，制定相应的采购计划，由供应链管理中心具体负责采购实施；在生产设备、检测仪器采购方面，由相关部门做出评估并经总经理确定后，由供应链管理中心进行采购。公司通过资信备案、样品认证、批量认证等严格把关，通过询价、比价及谈判确定采购价格，依客户交货日期要求与供应商协调交期，对供货质量严格实行到货检验。

公司建立了完善的采购管理体系，制订了规范的供应商遴选制度，核心物料最少有2家以上供应商供料并按评定分数分配采购额度，在降低供货风险的同时确保供货的质量及时效性。同时，公司对供应商建立了考评制度，及时淘汰不合格供应商，挑选新的优质供应商。

2、生产模式

公司产品生产主要采取“以销定产”和“订单式生产”相结合的模式，其中激光器产品根据客户需求，以销定产并分批次进行生产；激光/光学智能装备产品研发生产周期较长，结合订单需求进行生产；光纤器件标准化程度较高、单次需求量较大，以批量生产为主。公司存在少量委托加工的情况，对于部分加工难度较低、工艺不复杂的工序，由公司与外协厂家签订委托加工协议，委托其负责加工。外协厂商根据公司提供的原材料及技术指标等资料进行加工，公司品质部门将对加工产品进行质量抽检，有效实施质量控制流程，产品在检验合格后直接交货至公司库房。

整体而言，公司依据客户需求并结合订单制定生产计划，并依照公司《生产过程控制程序》制度文件执行生产计划。激光器的生产主要涉及测试、组装等工序；激光/光学智能装备产品的生产主要涉及研发、测试、组装等工序；光纤器件的生产主要涉及裁缆、固化、组装、研磨、端检等工序。在生产过程中，公司严格按照 Oracle EBS 管理系统分别进行生产前准备、生产执行、半成品管制与成品入库等工作。

3、销售模式

公司在国内外市场采用直销模式进行销售，公司与主要客户建立了稳定的合作关系，建立了较为完善的营销体系。

在激光器方面，公司主要通过专业展会树立企业形象，通过应邀参与行业沙龙、论坛等活动介绍公司技术优势和产品特点，并通过完善的售前与售后服务提升既有客户粘性。在新兴的应用领域，公司会与客户深入研究材料与激光的作用原理和应用效果，利用技术优势开发更适合特定领域的产品。在激光/光学智能装备方面，鉴于产品构成的复杂程度较高，且客户对产品的个性化需求较多，公司主要通过参与客户的生产应用场景，深入了解客户需求，并经过充分的方案沟通，形成最终产品研发设计方案并进行生产，实现产品销售。在光纤器件方面，针对通信设备制造商的光纤通信连接线产品以批量定制为主的销售特点，公司主要采取了持续开发和巩固大客户的营销策略。

在销售过程中的对外报价环节，公司首先由财务部会同生产部等进行产品成本测算，并由销售部门在产品的成本核算的基础上，结合公司发展计划、市场同类产品价格、销售情况、竞争对手价格、公司利润等综合因素，制定产品价格，报由相关部门、总经理审批通过后实施。

在销售过程的订单确认环节，公司与主要客户通常先签订销售框架协议约定产品定价、付款、质量保证及交付方式等交易条款，再根据客户订单约定具体的产品型号、数量和价格，这种供货需求订单通常批次多、批量大。由于公司产品具有按客户需求定制进行生产和销售的特征，公司与客户在产品研发、生产和销售方面形成较为紧密的合作关系。

4、研发模式

公司根据市场情况，以客户需求为导向，自主研发新产品和新技术，同时对具有商业化价值的科技成果进行转化生产。

公司的核心研发方向主要为各类激光器、激光/光学智能装备和光连接器件。根据项目研发难度，研发周期约为4个月至3年不等。在项目研发初期，研发部门通过对市场情况与客户需求进行调研，形成项目可行性的初步分析结论，进而建立项目研发小组对具体产品进行研发。在产品研发过程中，研发小组负责产品各部分参数的设计、原材料购买、元器件加工、安装调试，并在各环节进行必要的参数测试与参数优化，完成整机调试，确立最终参数。在产品研发完成后，新产品将交由生产部门进行小批量的试产试销，并为大批量生产销售做准备。

五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施

（一）发行人科技创新水平

公司作为一家专注于研发、生产和销售激光器、激光/光学智能装备和光纤器件的国家级高新技术企业，坚持“激光器+”的产业定位，沿着“光纤器件—激光器—激光技术解决方案”的发展路径持续升级现有产品，经过多年的发展，公司已经以激光核心技术为基础，打造了激光与光学、测试与测量、运动控制与自动化、机器视觉等技术平台，深耕上游核心激光光源技术，重点解决关键激光材料与部件的技术难题。

1、激光器

公司 MOPA 脉冲光纤激光器产品具有脉宽可调、频率范围广、响应速度快、首脉冲可用、全温度范围内输出功率波动小、体积小、噪声低等特点。产品脉冲频率和脉冲宽度独立可控，通过两项激光参数调整搭配，可实现恒定的高峰值功率输出。

公司连续光纤激光器产品自带软件可对激光器的运行状态进行实时监控及报警提示，并对运行数据进行收集记录，选择不同的输出头可实现单模和多模输出。从设计上具有可扩展性，通过多个模块（谐振腔）的合束可实现更高功率输出。

公司准连续（QCW）光纤激光器为全风冷结构，避免了使用体积庞大、功耗较大的水冷系统，使得设备结构更为紧凑，同时有效降低了使用成本，各项核心指标处于国内先进水平。公司自主研发的环形光斑可调光纤激光器是采用自产高功率合束系统，将激光分别导入多包层传输光纤的包层和纤芯，实现环形光斑可调；该产品是高端激光设备制造的核心部件，专为解决高反材料焊接的一款光纤激光器，是激光系统最重要的光源，广泛用于锂电、电子元器件、汽车制造等行业的激光切割 / 焊接应用。

公司固体紫外/绿光激光器内置空气自净化系统，使得激光器拥有更高水准的品质保障，一体化设计使得激光器具有较好的抗干扰、密封及防水性，重复频率范围较宽，应用效率较高。

2、激光/光学智能装备

公司激光/光学智能装备产品中包括激光光学模组、电路量测系统、运动控制模组、智能信息管理系统等自行研制的核心模组。通过对核心模组技术的掌握，公司得以在技术协同和利润率层面具有竞争优势。

公司应用在被动元件领域的激光调阻机系统利用了公司自行研制的 MOPA 脉冲光纤激光器,其脉宽可调的功能使得激光调阻机可以兼容不同类型的厚膜电阻、薄膜电阻、超高阻值电阻、超低阻值电阻等,更加灵活高效地服务客户。

在动力电池领域,公司持续配合客户在新工艺、新技术上的优化改进,如电池壳体毛化应用;大圆柱电池、固态电池里面激光应用技术优化以及用更高功率激光器产品提升客户电池加工效率等。2025 年公司服务的动力电池行业头部客户扩产需求旺盛,公司激光器产品持续配合客户进行激光器国产替代。

公司应用于消费级激光雕刻机的激光器产品已获得客户批量订单,公司持续推进激光雕刻机中脉冲光纤激光器替代二氧化碳激光器的工作。较传统激光器而言,公司自研的光纤激光器在加工材料的适配性及加工效率方面具有显著提升,有利于进一步提升产品适用范围。公司将与行业客户持续深化合作,为客户定制化迭代研发各类型激光器。目前公司配合行业内多家客户在激光器产品验证,预计未来将会有更多新增客户方面的突破。

公司根据不同焊接工序定制化研发的焊接监测模块如功率反馈补偿模块(PFM)、焊接过程监控模块(WPD)、焊接熔深监测模块(OCT)、温度监控系统等系列监测模块,能够更好地保障激光焊接效果。

公司的 VCSEL 激光模组检测系统中利用了自行研发的 VCSEL 驱动电路以及脉冲测试电路模块,在测试效率及测试精度方面更具竞争优势。

公司推出了完全自主可控的软性电路板激光微孔加工设备,设备使用公司自主研发的纳秒紫外激光器,可实现盲孔加工的工艺表现。报告期内,该款设备在国内电路板生产头部企业获得成功验证,有望逐步推进该款设备的国产替代,助力先进制造转型升级。

下一代 M9 电路板需要石英布层来作为电路板的“骨架”,而超快激光是目前行业内比较看好能够实现电路板微孔加工的方式。目前公司在配合行业头部客户进行关于下一代 M9 电路板生产所需的激光微孔加工设备以及激光器的研发。预计 PCB 行业也将受到 AI 算力需求的影响迎来新一波的需求增长。

报告期内,公司与新加坡雨树光科私人有限公司合作研发了新一代硅光晶圆级测试系统。新一代设备将实现以下关键技术突破:支持栅耦与边耦两种主流光耦合方式,覆盖更多芯片类型;栅耦耦合自动对准时间短,显著提升测试节拍;晶圆平台定位精度高,

满足高精度测试需求；兼容不同尺寸晶圆，支持多种封装形式的快速切换与测试流程复用，适应多元化生产场景；支持与 MES 等工厂系统无缝对接，可进行测试流程配置、实时状态监控和数据追溯。新一代产品将有效破解当前国内硅光芯片测试环节中的成本与效率瓶颈，支撑大规模量产需求。

3、光纤器件产品

公司光纤器件产品主要包括光纤连接器、光缆组件、光纤阵列单元等。报告期内，围绕光连接/光通信应用领域，面向数据中心、云计算、人工智能行业的产业需求，公司开发了 MPO/MMC 光纤连接器、光纤阵列单元 FAU 及各类光纤组件产品，相关产品主要应用于数据中心，作为数据在整个数据中心内传输的重要组成部件。

其中，MPO 与 MMC 是当前行业内广泛应用的两类高密度光纤连接技术，能够在单一连接器内集成多芯光纤，实现多芯数光缆的快速对接，显著提升布线效率、空间利用率及系统部署灵活性。FAU 作为精密光信号耦合与传输的关键器件，是实现多路光信号高效耦合、稳定传输的重要“枢纽”，在高速光模块、未来 CPO（共封装光学）高密度互联以及光芯片耦合场景中具有不可替代的作用。上述产品广泛应用于数据中心、超级计算、大型企业园区网络及高性能计算（HPC）等场景，为客户提供高带宽、高速率、高可靠性的数据传输解决方案。

未来，公司将充分发挥在精密光学检测、激光工艺及自动化系统集成方面的深厚技术积累，围绕 FAU 制程持续开发高精度、高效率的自动化解决方案，进一步提升生产良率与制造效率，构建差异化竞争优势。

4、公司获得的研发成果

截至 2026 年 3 月 31 日，公司已申请知识产权 900 项，其中发明专利 324 项、实用新型专利 320 项、外观设计专利 46 项、软件著作权 209 项、其他知识产权 1 项；公司已获授权的有效知识产权 486 项，其中发明专利 120 项、实用新型专利 139 项、外观设计专利 25 项、软件著作权 201 项、其他知识产权 1 项。

上述专利技术覆盖了公司主要技术环节，体现了公司深厚的技术实力和研发优势。

（二）发行人保持科技创新能力的机制和措施

为了满足客户的众多创新要求，进一步提升科技创新能力，公司目前加大在激光相

关装备、激光核心器件、激光新材料、数据中心建设以及公共研发平台等五大方面的研发投入，以开发、拓宽并深化激光技术解决方案的应用场景及服务能力。

公司积极倡导技术创新，建立了良好的人才激励机制，通过引进与培养相结合的方式构建了强大的技术研发团队，建立了完善的技术研发体系。此外，公司积极与高校、研究所、同行业企业、上下游企业等进行技术交流和有针对性的产品开发，获得了一系列的创新技术成果，同时培养了大批基础扎实、技术一流的工程技术人员，大大提升了整个技术团队的自主创新能力和技术水平。

六、现有业务发展安排及未来发展战略

公司将持续聚焦于主营业务，将现有的技术储备与业务布局相结合，顺应下游趋势，紧跟客户需求，进一步提升公司的技术实力，壮大研发人员队伍，增强交付完整解决方案的能力，夯实激光行业竞争力，进而有效提升公司的经营业绩与技术实力。具体如下：

激光器方面：公司以客户实际加工应用需求为导向，重点研发锂电、消费电子精密加工、被动元器件精密加工、柔性电路板/硬板电路板/陶瓷基板/玻璃基板激光加工领域所需脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器、半导体激光器和超快激光器产品。

激光/光学智能装备方面：公司以激光器研发为基础，打造激光与光学、测试与测量、运动控制与自动化、机器视觉等技术平台，在此基础上研发高端激光/光学智能装备，向超高精度调阻机、柔性及硬板、陶瓷基板、玻璃基板脆性材料微加工设备、芯片检测设备等细分领域拓展。

光通信方面：公司以客户实际需求以及行业未来技术发展方向为导向，重点拓展MPO/MMC、FAU产品生产能力以及产线自动化能力。在逐步提升产量的同时增强生产过程中自动化设备加工比例。

未来，公司将继续紧跟行业头部客户实际激光加工应用、光电检测及光纤器件产品需求，秉承着创新和差异化的研发思路加速新产品研发和现有产品升级，增强公司提供完善的一体化解决方案的能力，促进各业务板块协同发展，进而持续提升公司的核心竞争力。

七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

（一）财务性投资及类金融业务的认定标准及相关规定

根据中国证监会于 2026 年 4 月发布的《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（2026 年修正）第一款：

1、财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

2、围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

3、上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

4、基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

5、金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

6、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》对类金融业务作出了说明：除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构外，其他从事金融活动的机构为类金融机构，类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融计算口径。

（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司实施或拟实施的财务性投资情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关决议。自本次发行的董事会决议日前六个月（2025 年 10 月 27 日）至今，公司存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务，具体如下：

1、实施或拟实施的财务性投资

2026 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司与关联人共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，公司拟与公司控股股东、董事长、实际控制人黄治家先生，公司董事、副董事长刘健先生及其他非关联方共同出资设立嘉兴光汇富星创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光汇富星”）。2026 年 6 月 9 日，光汇富星完成工商登记，基本情况如下：

合伙企业名称	嘉兴光汇富星创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 224 室-41
执行事务合伙人	深圳前海力汇基金管理有限公司
规模	8,300.00 万元
成立日期	2026 年 6 月 9 日
统一社会信用代码	91330402MAKFUM3U5A
组织形式	合伙企业（有限合伙）
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经核查，截至募集说明书签署之日，光汇富星的股权结构如下：

股东名称	实缴金额（万元）	实缴比例（%）
刘健	2,120	25.54
杰普特	1,000	12.05
张磊	500	6.02
黄治家	500	6.02
其他股东	4,180	50.37
合计	8,300	100.00

光汇富星主营业务为创业投资，公司以获取该合伙企业的投资收益为主要目的，不具有该合伙企业的实际管理权或控制权，基于谨慎性原则认定为财务性投资。

2、投资类金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等类金融业务情形。

3、非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资金融业务的情形，也不存在向集团财务公司出资或增资的情形。

4、与公司主营业务无关的股权投资

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在新增与公司主营业务无关的股权投资。

5、投资产业基金、并购基金

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在新增投资产业基金、并购基金的情形。

6、拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在以赚取投资收益为目的的拆借资金的情形，不存在拆借资金的财务性投资。

7、委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在委托贷款的情形。

8、购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

综上所述，本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集资金说明书出具日，公司基于谨慎性原则认定的已投入的财务性投资合计 1,000 万元。公司在确定本次募集资

金规模时已经考虑前述财务性投资的影响，并在募集资金总额中扣除。

（三）是否存在最近一期末持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形

截至 2026 年 3 月 31 日，发行人可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关会计项目明细情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	2026 年 3 月 31 日账面余额	其中：财务性投资金额
1	货币资金	86,410.25	
2	交易性金融资产	10.16	
3	其他应收款	1,970.17	
4	其他流动资产	10,972.73	
5	长期股权投资	15,391.77	
6	其他非流动金融资产	8,342.63	6,725.02
7	其他非流动资产	990.04	

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	76.32	66.78	64.02	64.22
银行存款	75,105.42	74,212.12	30,536.22	39,867.13
其他货币资金	11,149.54	10,807.45	1,913.90	1,133.27
存款应计利息	78.97	7.85	19.97	13.15
合计	86,410.25	85,094.19	32,534.11	41,077.77

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 41,077.77 万元、32,534.11 万元、85,094.19 万元和 86,410.25 万元。公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、其他保证金、结构性存款等，不涉及财务性投资。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产的账面价值分别为 3,015.80 万元、500.11 万元、1,020.69 万元和 10.16 万元。公司交易性金融资产主要系银行结构性存款理财产品，

不涉及财务性投资。

3、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款的账面价值分别为 1,325.12 万元、1,338.92 万元、1,657.05 万元和 1,970.17 万元。公司其他应收款主要为押金及保证金等，不涉及财务性投资。

4、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别是 8,045.50 万元、9,431.11 万元、9,413.27 万元和 10,972.73 万元，主要为待认证和待抵扣进项税额、预缴所得税及待摊费用，不涉及财务性投资。

5、长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资明细如下：

单位：万元				
联营企业	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
武汉长进光子技术股份有限公司	9,143.70	8,950.38	6,574.02	5,589.15
苏州欧亦姆半导体设备科技有限公司	1,269.97	1,375.34	1,340.88	1,369.98
深圳市极致激光科技有限公司	281.55	307.14	321.09	387.97
深圳睿晟自动化技术有限公司	4,677.83	4,473.59	3,616.14	2,781.53
喜悦光子（深圳）科技有限公司	-1.14	-0.89	0.00	0.00
深圳市奥信电子有限责任公司	19.87	19.90	19.98	0.00
合计	15,391.77	15,125.47	11,872.11	10,128.62

注：喜悦光子（深圳）科技有限公司已于 2026 年 6 月 5 日注销。

报告期各期末，公司长期股权投资期末余额分别为 10,128.62 万元、11,872.11 万元、15,125.47 万元和 15,391.77 万元。报告期内，公司长期股权投资由对联营企业的投资款构成，主要包括武汉长进光子技术股份有限公司、苏州欧亦姆半导体设备科技有限公司、深圳市极致激光科技有限公司、深圳睿晟自动化技术有限公司等，均与公司的主营业务密切相关，不属于财务性投资。

6、其他非流动金融资产

报告期各期末，公司其他非流动金融资产余额分别是 7,291.67 万元、8,738.52 万元、8,349.63 万元和 8,342.63 万元，系对芜湖恒和一号股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海青稞晨曦壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投杰普特产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东高端元器件创新科技有限公司、Guard Glow Inc.、武汉云智光联科技有限公司及深圳市随动智能技术有限公司的权益工具投资。

公司持有的上述对广东高端元器件创新科技有限公司、Guard Glow Inc.、武汉云智光联科技有限公司和深圳市随动智能技术有限公司的投资均为公司围绕主营业务或所在行业产业链上下游相关公司的投资，其主要目的为通过长期性的产业投资，拓展完善公司的产业布局，降低公司经营风险，而不在于通过转让投资获取财务性收益，均不属于财务性投资。

截至报告期末，公司参股的三家合伙企业的具体情况如下：

公司名称	投资方向	对外投资情况	与发行人在产业链上的关系
深圳市高新投杰普特产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	成都远望未来雷达科技股份有限公司；光未来金属科技（上海）有限公司；苏州芯睿科技有限公司	产业链下游
珠海青稞晨曦壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	上海拓璞数控科技股份有限公司；皇冠新材料科技股份有限公司；湖北泰和流体控制技术股份有限公司；天津异乡好居股份有限公司；济南晶正电子科技有限公司；深圳市欧冶半导体有限公司；广州瑞派医疗器械有限责任公司；深圳屹良科技有限公司；北京童康汇网络科技有限公司；深圳新顿科技有限公司	产业链下游
芜湖恒和一号股权投资合伙企业（有限合伙）	投资管理、股权投资	深圳市强达电路股份有限公司；上海超硅半导体股份有限公司	产业链下游

公司基于谨慎性原则将对上述三家合伙企业的投资认定为财务性投资。

7、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别是 348.93 万元、2,239.33 万元、618.32 万元和 990.04 万元，主要为预付长期资产款项、留抵进项税、期限一年以上的大额存单等构成，不涉及财务性投资。

综上所述，公司最近一期末存在对三家股权投资合伙企业权益工具投资的财务性投

资，期末账面价值为 6,725.02 万元，合计占归属于母公司净资产的比例为 3.16%，发行人最近一期末不存在金额较大的财务性投资或类金融投资，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关要求。

八、本次发行不存在违法行为、资本市场失信惩戒相关情形

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管理人员不存在《发行注册管理办法》第十一条（三）至（六）项规定的情形：

1、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

2、发行人或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

3、发行人控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

4、发行人最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

第二章 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、公司所从事的业务顺应国家战略规划，受国家及产业政策的支持

公司主要经营激光器、激光/光学智能装备和光纤器件业务，其中激光器、激光/光学智能装备业务需要融合激光与光学、测试与测量、运动控制与自动化、机器视觉等领域的核心技术，属于新一代信息技术、新材料与高端装备制造相融合的高新技术与战略性新兴产业。2018 年，统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》将各类激光器和激光精密加工设备列入指导目录；2021 年，工信部、发改委等八部门出台的《“十四五”智能制造发展规划》强调要发展智能焊接机器人、超快激光等先进激光加工装备、激光跟踪测量等智能检测装备和仪器等；《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将多项激光器及相关智能装备明确列入鼓励类目录；2024 年，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出将发展激光制造纳入前瞻部署新赛道，推进未来制造产业发展；《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》提出重点推动激光打孔等封装与装联材料专用生产设备，支持电子元器件和电子材料行业发展。相关政策的陆续出台，为激光器、激光设备产业的智能化升级营造了良好的政策环境。

公司所从事的光通信领域光纤器件业务，是数据中心、云计算、人工智能等行业发展的重要产品。从“十四五”规划提出“培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平”，到“十五五”规划进一步要求“完善信息通信网络、全方位推进数智技术赋能”，光通信行业的产业政策力度也逐步加强，政策效果日益显现。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的部署，“十五五”期间将完善信息通信网络，深化第五代移动通信（5G）、千兆光网规模部署，推进第五代移动通信演进（5G-A）、万兆光网建设发展和第六代移动通信（6G）技术创新，推动移动物联网自主迭代，具体建设内容为：“推进万兆光网部署应用，建设 100 万个高速无源光网络（50GPON）端口”。全方位推进数智技术赋能，壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平，

打造具有国际竞争力的数字产业集群。上述政策直接促进了国内光通信网络的建设与升级，带动光连接/光通信产业对核心光纤器件的需求增长。

国家及产业政策的持续出台和实施，为本次募投项目的建设实施创造了良好的政策环境，符合国家战略规划。

2、下游行业蓬勃发展，激光器、激光装备产业国产化进程加速，光纤器件需求迎来爆发

近年来，我国激光行业的国产化替代进程不断加快，替代质量显著提升。受全球供应链系统波动影响，部分进口激光器及激光加工设备的产能与交付能力受限，无法满足国内激光加工行业旺盛的需求。在宏观经济发展、产业升级、国家政策支持等多重因素的影响下，国产激光器及智能激光设备在性能、价格、服务等多方面逐步优于进口激光器、进口激光加工设备，未来几年激光器、激光加工设备国产替代率将持续提高。在我国传统制造业逐步向智能化转型的背景下，激光行业正朝着精细化、智能化、与下游产业深度融合化的方向发展。提高公司在激光技术等方面的研发实力，进一步开发出更加充分、全面满足下游客户需求的高规格、高质量的激光器产品及激光加工设备，是推动技术升级与创新，提升产品竞争力和附加值的必然要求。

2025 年以来，受益于 AI 算力和数据中心需求快速增长，光通信市场景气度持续提升，全球各大云服务商及超大规模数据中心运营商不断上调资本开支计划。据 Bloomberg 数据，2026 年 Meta、谷歌、亚马逊和微软等四家公司的合计资本开支预计达 6,300-6,700 亿美元，同比增长约 70%。2026 年中国算力基建投入达到 5,000 亿元人民币水平。根据国际数据公司(IDC)与浪潮信息联合发布《2025 年中国人工智能计算力发展评估报告》，2024 年全球人工智能服务器市场规模为 1,251 亿美元，2025 年将增至 1,587 亿美元，2028 年有望达到 2,227 亿美元。同时，随着 CPO 技术逐步进入规模化商用阶段，单台 CPO 交换机可承载和输出的光纤通道数较传统方案将显著增加，相应将对关键光纤器件提出高密度的配置需求，以及更复杂的性能要求，以支持各端口光纤通道的高效稳定连接。在上述因素驱动下，光通信市场需求快速增长，光连接模块及器件作为光通信领域的关键基础组件相应迎来发展机遇，根据 LightCounting 测算，2026 年全球光模块数通市场 228 亿美元，至 2030 年复合增速为 20%；2026 年全球光模块电信市场 53 亿美元，至 2030 年复合增速为 7%。

3、符合公司技术储备与业务布局，促进公司实现战略升级

经过十余年的科研积累和业务发展，公司已成长为国内激光行业的领先企业之一，拥有丰富的技术储备、研发经验和客户资源，赢得了一定的市场占有率和品牌知名度，成为中国首家商业化批量生产 MOPA 脉冲光纤激光器的厂商。本次募集资金投资项目与公司现有技术储备和产品布局相结合，顺应行业发展和技术演进趋势，紧跟客户需求，有利于进一步提升公司的技术实力，增强交付完整解决方案的能力，巩固并提升公司的行业竞争力，进而提高公司经营业绩。

公司以自有激光器、激光/光学智能装备为基础，在产品研发与产业化过程中沉淀形成了激光光源、精密量测、运动控制、机器视觉、光学设计、元器件精密加工等重要技术储备，相关底层技术与光通信器件在加工工艺、光学耦合、精密装配、性能测试等领域高度契合，技术能力能够有效复用。公司将结合自身在激光加工、自动化制造及光学检测领域长期积累的技术优势，针对光通信高密度光纤器件制造工艺需求，加快研发光纤器件生产所需的自动化设备、激光设备及检测设备，推动光纤器件产品生产向规模化、智能化量产方向发展，保障产品的可靠性、稳定性以及一致性，同时提升生产效率、优化制造成本。公司将运用长期积累的激光技术充分赋能光通信核心器件业务，从而构建核心技术储备、关键设备自研、产品自动化生产和稳定交付能力等全方位优势，切实推进“光+AI”战略升级。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、增强光通信领域关键基础器件交付能力，积极把握行业爆发机遇

公司围绕光连接/光通信应用领域，面向数据中心、云计算、人工智能行业的产业需求，开发了 MPO/MMC 光纤连接器、光纤阵列单元 FAU 及各类光纤组件产品，相关产品主要应用于数据中心，作为数据在整个数据中心内传输的重要组成部件。2025 年度，公司积极展开关于光通信领域 MPO、MMC、FAU 等光纤器件产品的布局，光纤器件业务收入迅速增长至 1.43 亿元，较 2024 年度增加 560.42%，产品已获得知名客户在质量以及交付能力方面的高度认可。

2025 年以来，全球光通信市场景气度持续提升，数据中心、云计算、人工智能行业对高密度、高带宽、低能耗光纤器件的需求日益增长，同时 MPO、MMC、FAU 作为高端无源器件，技术壁垒显著，头部企业纷纷凭借产能规模与技术优势抢占市场份额。

公司拟通过本次募集资金项目建设，打造规模化、柔性化、智能化光纤器件生产基地，进一步增强光纤器件批量交付能力，深度绑定头部客户的长期供货需求，积极把握“光+AI”融合创新的产业发展机遇，提升公司光纤器件业务的市场占有率和核心竞争力。

2、加速激光器及相关产品研发创新，拓宽产品矩阵，促进各业务板块协同发展

近年来，激光行业保持高速发展与高质量的技术进步，在具体应用领域上持续满足下游客户的创新性、差异化需求，客户对激光核心部件及智能装备的需求正朝着高功率、窄脉宽、短波长等更多元化、更高效化的方向发展。激光产业作为高新技术与战略性新兴产业，技术实力是企业的核心竞争力，行业内企业之间的竞争集中体现在产品的创新性、智能化、可靠性，集中反映在根据客户需求提供整体解决方案的能力。

公司作为国内激光行业的领先企业之一，坚持“激光器+”的产业定位，沿着“光纤器件-激光器-激光技术解决方案”的发展路径，兼顾现有产品迭代升级和新产品扩展延伸。公司深耕激光行业多年，以激光核心技术为基础，成功打造了激光与光学、测试与测量、运动控制与自动化、机器视觉等技术平台，能够为客户高效提供完善的一体化解决方案。

本次募集资金投资项目实施后，公司将加快升级研发软硬件设施，补强研发团队，进一步提升公司的技术实力，以紧跟激光器、光通信行业前沿趋势，重点加速飞秒激光器、高密度光纤器件及相关产品和智能装备的研发创新，拓宽产品矩阵，促进各业务板块协同发展，更好地满足客户对产品持续提出的更高标准和差异化需求，进而提升公司的核心竞争力。

3、进一步增强资金实力，满足经营规模快速扩张带来的营运资金需求，推动公司持续高质量发展

公司主营业务产品顺应激光器、光通信行业发展趋势和技术演进方向，符合产业政策及规划，2023年度至2025年度，公司营业收入规模保持快速扩大，年均复合增长率超过30%。当前，公司正处于政策鼓励、行业扩张、业务发展的重要机遇期，但营收规模持续扩大也对公司资金实力提出更高的要求，一方面存货、应收账款等经营性资金占用相应增多，另一方面也带动原材料采购、薪酬支出、市场开拓等方面对营运资金的需求增加；此外，研发平台升级、产能扩张亦需要充足的资金支持。

通过本次向特定对象发行，公司将充分利用资本市场优势，进一步增强资金实力，

并使用部分募集资金用于补充流动资金，以满足经营规模快速扩张带来的营运资金需求，降低公司的财务风险和经营风险，提高公司盈利能力，推动公司持续高质量发展。

二、发行对象及与发行人的关系

（一）发行对象

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，经中国证监会作出同意注册决定后，与主承销商按照相关法律、法规及规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

（二）发行对象与公司的关系

截至本募集说明书签署日，公司本次发行 A 股股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（即“发行底价”）。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

最终发行价格由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，经中国证监会作出同意注册决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定，但不低于前述发行底价。

若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则本次发行的发行底价按照上海证券交易所的相关规则相应调整。

（二）发行数量

本次发行的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。

最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。

在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

（三）限售期

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象基于本次发行所得股份因公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。

四、募集资金金额及投向

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过 138,297.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		项目投资总额	募集资金使用额
1	高密度光互联产品生产建设项目	杰普特高密度光互联产品生产基地建设项目	75,218.80	67,304.00
		杰普特高密度光互联产品生产綫建设项目	10,856.20	9,256.00
		小计	86,075.00	76,560.00
2	杰普特总部及研发中心升级建设项目		24,713.00	21,737.00
3	补充流动资金		40,000.00	40,000.00
合计			150,788.00	138,297.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至本募集资金说明书签署日，公司总股本为 95,049,423 股。发行人的控股股东、实际控制人为自然人黄治家，直接持有发行人 18,275,464 股，占公司总股本的 19.23%，并通过其担任执行事务合伙人的同聚同源控制公司 12,477,042 股股份，占公司总股本的 13.13%。此外，黄治家一致行动人黄淮直接持有发行人 2,520,648 股股份，占公司总股本的 2.65%。因此，黄治家直接或间接控制公司 35.01% 的股份。

本次向特定对象拟发行不超过本次发行前发行人总股本的 30%，即不超过 28,514,826 股。在不考虑可能导致公司总股本或股权结构发生变化的其他事项的前提下，

本次发行完成后发行人的总股本不超过 123,564,249 股。按发行 28,514,826 股上限测算，本次发行完成后，黄治家本人直接持有发行人的股份比例为 14.79%，通过同聚同源控制发行人的股份比例为 10.10%，一致行动人黄淮持有发行人的股份比例为 2.04%，因此黄治家合计控制发行人 26.93%的股份。

鉴于：（1）公司整体股权结构分散，在本次发行完成后，黄治家控制的发行人股份所代表的表决权比例仍为最高；（2）报告期内，黄治家一直担任发行人的董事长，在发行人的董事会和日常管理决策中均能够产生重大影响。因此在本次发行后，黄治家仍拥有发行人的控制权，仍保持控股股东、实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行已经由 2026 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十四次会议，2026 年 5 月 14 日公司召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 138,297.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金拟投资于以下项目及补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称		项目投资总额	募集资金使用额
1	高密度光互联产品生产建设项目	杰普特高密度光互联产品生产基地建设项目	75,218.80	67,304.00
		杰普特高密度光互联产品生产线建设项目	10,856.20	9,256.00
		小计	86,075.00	76,560.00
2	杰普特总部及研发中心升级建设项目		24,713.00	21,737.00
3	补充流动资金		40,000.00	40,000.00
合计			150,788.00	138,297.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）高密度光互联产品生产建设项目

1、项目概况

公司本次发行股票，拟使用募集资金合计 76,560.00 万元用于建设高密度光互联产品生产建设项目，具体分为两个子项目，其中“杰普特高密度光互联产品生产基地建设项目”建设地点位于惠州激光光电智能制造基地，建设期预计为 24 个月；“杰普特高

密度光互联产品生产线建设项目”建设地点位于惠州光纤激光产业园，建设期预计为12个月。

公司拟打造自动化水平高、空间结构布局合理、清洁环保的光纤器件生产基地，用于生产MPO、MMC、FAU等高密度光互联产品，以满足数据中心、超级计算、大型企业园区网络及高性能计算需求。项目建成投产后，将有效提升公司对光连接/光通信领域关键基础部件的供应能力，把握行业发展机遇，提高公司光纤器件业务的市场占有率和核心竞争力，并有望推动光纤器件业务板块成为公司新的收入增长点。

2、项目实施的必要性

（1）本项目的实施是顺应光通信行业发展趋势，提升公司业务规模的重要措施

随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术快速发展，以ChatGPT为代表的生成式AI对算力提出了更高的要求，为光通信产品的需求带来巨大增量。数据中心光通信技术持续迭代，传输速率为800G的高速光模块实现规模化量产，并逐步向1.6T超高带宽演进，整体技术架构同步从传统可插拔光模块，向OIO板载光互连、CPO共封装光学、OCS光电路交换的高密度、低功耗、低时延集成化方向升级，是适配大规模AI算力集群高速数据传输、智能光路调度的核心产业趋势。其中，MPO多芯光纤连接器是数据中心高密度布线、OCS设备光路集成的主流互连器件；MMC微型多芯光纤连接器作为MPO的小型化升级产品，有效解决1.6T及以上高速场景、OIO与CPO封装场景的空间受限、通道密度不足的行业痛点，是支撑高速光模块、硅光集成、CPO、OCS等前沿技术落地的关键核心元器件；FAU光纤阵列单元是硅光芯片、高速光模块及CPO光引擎实现光纤精密耦合的核心基础部件，直接决定产品传输损耗与量产良率。上述光连接/光通信器件均为顺应光通信发展趋势、适用多种技术方案、保障AI算力网络高效稳定运行的关键器件。

光纤器件承担着光信号的产生、调制、探测、接收、连接、传导、发送、波分复用和解复用、光路转换、信号放大、光电转换等功能，是光通信网络核心组成部分。在AI算力爆发、数据中心高密度升级、CPO技术逐步普及等多重因素驱动下，全球光通信市场关键器件需求快速扩张。在前述背景下，公司加速布局MPO、MMC、FAU等高密度光互联产品业务，是顺应光通信行业发展和技术演进趋势、抢抓下游需求爆发机遇、进而提升市场占有率和业务规模的重要措施。

(2) 本项目的实施是公司提升高密度光互联产品交付能力，增强综合竞争力的必然之举

公司围绕光连接/光通信应用领域，面向数据中心、云计算、人工智能行业的产业需求，开发了 MPO/MMC 光纤连接器、光纤阵列单元 FAU 及各类光纤组件产品，相关产品主要应用于数据中心中，作为数据在整个数据中心内传输的重要组成部件。2025 年度，公司积极展开关于光通信领域 MPO、MMC、FAU 等光纤器件产品的布局，光纤器件业务收入迅速增长至 1.43 亿元，较 2024 年度增加 560.42%，产品已获得知名客户在质量以及交付能力方面的高度认可。面对下游数据中心、云计算、人工智能行业对高密度、高带宽、低能耗光纤器件的需求日益增长，公司产能已显不足，无法满足头部客户批量交付与长期供货需求。

通过本项目建设，公司将充分发挥在光纤器件制造上的技术优势，有效提高公司光纤器件产品生产效率，提升公司在光通信关键器件的供应能力和市场占有率，进一步增强公司在光连接与光通信核心器件领域的综合竞争优势。

3、项目实施的可行性

(1) 国家产业政策为项目实施提供了良好的政策支持

2025 年以来，围绕云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术行业，国家相关部门陆续出台了多项政策，鼓励行业发展与创新，带动光连接/光通信产业对核心光纤器件的需求增长。工信部发布《算力互联互通行动计划》，提出统筹推动先进计算产业融合创新发展，加强高速互联总线等基础软硬件技术攻关，推动数据通信产业高质量发展；国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，要求到 2027 年实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合、新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%，到 2030 年普及率超 90%，到 2035 年我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段；《关于加快推进国家新型互联网交换中心创新发展的指导意见》提出推动人工智能、400G/800G 光传送、无损以太、隐私计算、量子通信等前沿技术在交换中心部署和应用，提升网络交换效率和智能化运营水平。国家及产业政策的持续出台和实施，为未来光通信市场的增量发展提供了有力政策支持，有助于本项目的顺利实施。

(2) 充足的技术储备赋能项目实施，帮助公司构建全面优势

公司作为国家级高新技术企业，是国内领先的激光器生产制造商和光电精密检测及

激光加工智能装备提供商，同时加速布局 MPO、MMC、FAU 等光连接/光通信领域产品，已取得多项发明专利，具有较强的产品创新和研发能力。

从技术角度来看，公司以自有激光器、激光/光学智能装备为基础，在产品研发与产业化过程中沉淀形成了激光光源、精密量测、运动控制、机器视觉、光学设计、元器件精密加工等重要技术储备，相关底层技术与光通信器件在加工工艺、光学耦合、精密装配、性能测试等领域高度契合，技术能力能够有效复用。在具体生产流程方面，MPO、MMC、FAU 等光纤器件产品生产过程关键环节包括剥纤、穿纤、注胶、固化、研磨和测试等，其中多个环节应用智能激光设备。公司将结合自身在激光加工、自动化制造及光学检测领域长期积累的技术优势，针对光通信高密度光纤器件制造工艺需求，加快研发光纤器件生产所需的自动化设备、激光设备及检测设备，推动光纤器件产品生产向规模化、智能化量产方向发展，保障产品的可靠性、稳定性以及一致性，同时提升产品生产效率、优化制造成本。

公司拥有充足的技术储备，将运用长期积累的激光技术充分赋能光通信核心器件业务，从而构建核心技术储备、关键设备自研、产品自动化生产和稳定交付能力等全方位优势。

(3) 持续扩大的市场需求和优质的客户资源为项目新增产能消化提供充分保障

2025 年以来，受益于 AI 算力和数据中心需求快速增长，光通信市场景气度持续提升，全球各大云服务商及超大规模数据中心运营商不断上调资本开支计划。据 Bloomberg 数据，2026 年 Meta、谷歌、亚马逊和微软等四家公司的合计资本开支预计达 6,300-6,700 亿美元，同比增长约 70%。2026 年中国算力基建投入达到 5,000 亿元人民币水平。根据国际数据公司(IDC)与浪潮信息联合发布《2025 年中国人工智能计算力发展评估报告》，2024 年全球人工智能服务器市场规模为 1,251 亿美元，2025 年将增至 1,587 亿美元，2028 年有望达到 2,227 亿美元。同时，随着 CPO 技术逐步进入规模化商用阶段，单台 CPO 交换机可承载和输出的光纤通道数较传统方案将显著增加，相应将对关键光纤器件提出高密度的配置需求，以及更复杂的性能要求，以支持各端口光纤通道的高效稳定连接。在上述因素驱动下，光通信市场需求快速增长，光连接模块及器件作为光通信领域的关键基础组件相应迎来发展机遇，根据 LightCounting 测算，2026 年全球光模块数通市场 228 亿美元，至 2030 年复合增速为 20%；2026 年全球光模块电信市场 53 亿美元，至 2030 年复合增速为 7%。

当前光通信市场前景良好，云厂商、光模块厂商为保障供应链安全，寻求与核心光纤器件供应商签订长期采购协议锁定产能，市场需求确定性较强。经过前期持续布局，2025 年度公司光纤器件业务收入迅速增长至 1.43 亿元，客户群体涵盖数据中心、AI 算力领域头部企业，且与下游核心客户建立了深度稳定的合作关系。因此，下游光通信领域持续扩大的市场需求，以及公司优质的客户资源储备预计能够充分消化为本次光纤器件新增产能。

4、项目投资概况

本项目的实施主体为公司全资子公司惠州市杰普特电子技术有限公司，项目总投资额为 86,075.00 万元，主要包括土地购置费、建设工程费、软硬件设备购置、基本预备费和铺底流动资金等。其中拟使用募集资金投资额合计为 76,560.00 万元，其余资金由公司通过自筹解决，具体投资规划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金
1	建设投资	76,560.00	76,560.00
1.1	土地购置费用	2,430.00	2,430.00
1.2	场地建设投入	26,719.00	26,719.00
1.3	设备及软件投入	47,411.00	47,411.00
2	预备费	3,828.00	-
3	铺底流动资金	5,687.00	-
合计		86,075.00	76,560.00

5、项目实施进度及安排

项目进度安排（月）	T+3	T+6	T+9	T+12	T+15	T+18	T+21	T+24
工程设计及准备工作								
土建及装修工程								
设备及软件购置								
人员招聘、培训								
试运行与验收								

6、效益测算

本项目效益测算假设公司现有经营环境和行业政策未发生重大变化，项目内部收益率（税后）为 17.27%，税后投资回收期为 8.13 年（含建设期），项目经济效益前景良好。本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

（1）营业收入测算

项目营业收入根据高密度光互联产品预计销量，乘以预计单价测算，其中：产品销量系根据项目产能进行预计，符合未来市场需求、发行人客户储备和产能规划；产品单价系根据同类产品过往单价、并参考市场价格，基于谨慎性原则预计。

（2）营业成本和费用预测

项目产品成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用。直接材料主要综合考虑项目产品材料成本及市场行情进行合理估算，直接人工根据项目生产人员需求及发行人现有薪酬水平进行估算；制造费用主要包括生产设备和厂房等固定资产折旧、土地使用权和软件等无形资产摊销、间接人工等，其中生产设备折旧按照 10 年折旧期、10%残值率进行测算，房屋建筑物按照 35 年折旧期、10%残值率进行测算，土地使用权按照 50 年摊销期进行测算，软件按照 5 年摊销期进行测算，其他制造费用参考发行人历史水平进行测算。

项目期间费用主要包括销售费用、管理费用和研发费用，参考发行人光纤器件业务历史费用率，并结合募投项目实际情况进行测算。

（二）杰普特总部及研发中心升级建设项目

1、项目概况

公司本次发行股票，拟使用募集资金 21,737.00 万元用于杰普特总部及研发中心升级建设项目，建设期预计为 36 个月。项目计划在深圳杰普特湾区激光谷大厦建设，资金主要用于软硬件购置、实验室优化等关键环节，从而增强在激光相关装备、激光核心器件、激光新材料、数据中心建设以及公共研发平台等五大方面的创新能力，帮助公司紧跟行业发展趋势，进一步提升改善技术水平和产品创新能力，拓展产品矩阵，从多维度解决客户痛点问题，为客户提供更好的激光领域一体化解决方案，进一步增强公司的核心竞争力。

2、项目实施的必要性

（1）本项目的实施有利于公司升级研发软硬件平台，增强研发实力

公司深耕上游核心激光光源技术，为满足客户的众多个性化需求，持续加大在激光相关装备、激光核心器件、激光新材料、数据中心建设以及公共研发平台等五大方面的研发投入，以开发、拓宽和深化激光技术解决方案的应用场景及服务能力。

通过本次杰普特总部及研发中心升级建设项目，公司将打造设备先进、功能全面、运营高效的数字化激光领域研发中心，进一步升级研发软硬件平台，开展更多类型、更具针对性的技术研发和创新工作，并积极实现技术成果转化。项目实施后，公司将有效改善研发条件，有利于增强公司的研发实力，全面提高公司的技术创新水平，保持公司产品先进性。

（2）本项目的实施有利于公司吸引优秀人才，加深人才储备

公司所从事的激光器、激光/光学智能装备和光纤器件业务，属于新一代信息技术、新材料与高端装备制造相融合的高新技术与战略性新兴产业，对专业性的研发人才需求较大：一方面，企业综合实力和市场竞争力的比拼，集中体现在人才与技术的竞争；另一方面，行业加速发展和技术快速迭代也对研发团队的技术全面型、先进性提出更高要求，科技企业均需投入大量精力招揽研发及技术人才。

公司深耕激光领域十余年，已凝聚了一批优秀的研发人才。然而，随着行业技术不断进步和公司持续快速发展，公司研发人员在数量上、深度上仍然无法充分满足技术创新和产品迭代需求，一定程度上制约着公司发展空间。本项目建设实施后，预计能够有效吸引高素质技术人才加入，积极改善企业的科研环境，有利于公司扩大研发人员队伍，优化公司人才梯队，增强公司人才储备，保持乃至提高公司的技术领先地位和行业竞争力。

（3）本项目的实施有利于促进激光产业的国产替代进程

作为国家产业政策长期重点支持领域，我国激光器行业持续发展，产品技术不断更新迭代。但受限于激光器中的泵浦源、激光脉冲调制器件等核心器件的制程技术门槛较高，我国部分激光器产品仍在一定程度依赖进口，中高功率激光器国产化率有待进一步提升。

作为一家深耕激光器、激光/光学智能装备的国家级高新技术企业，公司自主研发的 MOPA 脉冲光纤激光器在国内率先实现了批量生产和销售，填补了国内该领域的技术空白。近年来，公司紧密围绕客户对激光技术解决方案的需求，已开发多款具有创新性的激光/光学智能装备，广泛应用于激光精密加工、光谱检测、光学检测、消费电子产品制造、贴片元器件制造、光伏电池片制造等领域。项目实施后，公司将进一步补强人才团队、设备资源和资金实力，持续加大飞秒激光等高端激光器及相关智能装备的研发投入，积极促进我国激光产业的技术进步，加速国产替代进程。

3、项目实施的可行性

（1）国家产业政策为项目实施营造良好的政策环境

激光产业是国家长期重点鼓励的产业，国家陆续出台多项政策支持行业发展。2018 年，国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》将各类激光器和激光精密加工设备列入指导目录；2021 年，《“十四五”智能制造发展规划》强调“十四五”期间，我国将大力发展智能装备，包括智能焊接机器人、超快激光等先进激光加工装备、激光跟踪测量等智能检测装备和仪器等；《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将多项激光器及相关智能装备明确列入鼓励类目录。国家及产业政策陆续出台，重点支持激光技术、尤其是高端智能装备的创新应用，鼓励科技企业加大研发投入，提高行业技术水平，为本项目建设营造了良好的政策环境。

（2）长期积累的技术实力和科技成果产业化经验是项目推进的坚实基础

公司作为一家专注于研发、生产和销售激光器、激光/光学智能装备的国家级高新技术企业，高度重视新技术和新产品的开发。自成立以来，公司深耕上游核心激光光源技术，重点解决关键激光材料与部件的技术难题，沿着“光纤器件-激光器-激光技术解决方案”的发展路径快速扩张。经过多年发展，公司以激光器研发为基础，打造了激光与光学、测试与测量、运动控制与自动化、机器视觉等技术平台，在激光器、激光/光学智能装备等领域拥有较为全面的技术积累。截至 2026 年 3 月 31 日，公司已获授权的有效知识产权 477 项，其中发明专利 120 项、实用新型专利 139 项、外观设计专利 25 项、软件著作权 192 项、其他知识产权 1 项。公司积累了深厚的技术实力和科技成果产业化经验，将为本项目顺利推进提供坚实的基础。

（3）高素质的研发团队为项目开展提供充分的技术支持

公司高度重视科技人才的培养和引进，已逐步建立起一支以深圳和新加坡为中心的国际化研发团队。截至 2026 年 3 月 31 日，公司研发人员数量为 550 人，核心技术团队汇集了众多涉及光学设计、电子技术、精密机械、自动化、软件等不同学科背景的海外留学归国人才及国内高层次人才，拥有丰富的光学、自动化控制以及机器视觉检测等行业研发经验，对产业发展方向和下游市场需求有着深刻理解。

公司研发团队深耕激光及相关领域，践行公司“激光器+”发展理念，秉承着创新和差异化的研发思路，已成功研发设计多款具有创新性的产品，其中公司自主研发的 MOPA 脉冲光纤激光器已实现国产替代，填补了国内该领域的技术空白。高素质的研发团队将为项目开展提供充分的技术支持。

4、项目投资概况

本项目的实施主体为深圳市杰普特光电股份有限公司，项目总投资额为 24,713.00 万元，主要包括建设工程费、软硬件设备购置等。其中拟使用募集资金投资额为 21,737.00 万元，其余资金由公司通过自筹解决，具体投资规划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金
1	建设投资	21,737.00	21,737.00
1.1	设备及软件投入	11,619.00	11,619.00
1.2	场地投入	10,118.00	10,118.00
2	预备费	1,085.00	-
3	项目实施费用	1,891.00	-
合计		24,713.00	21,737.00

5、项目实施进度及安排

本项目建设期为 36 个月，项目将按照工程设计及准备、场地装修、软硬件设备购置及安装调试等进度实施，具体项目实施进度及安排如下：

项目进度安排（月）	T+3	T+6	T+9	T+12	T+15	T+18	T+21	T+24	T+27	T+30	T+33	T+36
工程设计及准备工作												
装修工程												
设备及软件购置及安装调试												

项目进度安排（月）	T+3	T+6	T+9	T+12	T+15	T+18	T+21	T+24	T+27	T+30	T+33	T+36
人员招聘、培训												
项目验收												

6、效益测算

“杰普特总部及研发中心升级建设项目”旨在升级发行人研发软硬件平台，吸引优秀研发人才，以加速推进新技术、新产品研发进度，进一步增强发行人研发实力和核心竞争力，保持发行人行业地位和技术优势，项目不产生直接经济效益，不涉及经济效益测算。

（三）补充流动资金

1、项目概况

公司本次发行股票，拟使用募集资金 40,000.00 万元用于补充流动资金，有助于缓解公司经营规模快速增长过程中的流动性压力，保障公司可持续发展和经营稳定性。

2、项目实施的必要性

在市场和国家政策推动下，近年来我国激光产业发展迅速，下游行业需求旺盛，公司业务规模也不断发展壮大，2023 年度至 2025 年度，公司营业收入年均复合增长率超过 30%。公司经营规模持续快速扩大，一方面存货、应收账款等经营性资金占用相应增多，另一方面带动原材料采购、薪酬支出、市场开拓等方面对营运资金的需求增加，同时，规划建设项目亦存在一定营运资金需求。使用部分募集资金用于补充流动资金，可以满足公司业务快速扩张需要，保障公司可持续发展，降低经营风险。此外，本次发行完成后，能够进一步优化公司资本结构，减少对债务融资的需求，降低资产负债率和财务风险。因此，本次募集资金部分用于补充营运资金具备必要性。

3、项目实施的可行性

公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合中国证监会、上海证券交易所的相关监管规定，具有可行性。公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。因此，本次募集资金用于补充流动资金具备可行性。

4、补充流动资金的原因及合理性

报告期内，公司营业收入分别为 122,562.53 万元、145,384.62 万元、207,402.43 万元和 66,086.25 万元，整体保持快速增长趋势，近三年年均复合增长率超过 30%。随着主营业务规模持续快速扩张，同时下游光通信行业需求迎来爆发，公司对流动资金的需求也相应提高。因此，公司拟使用部分募集资金用于补充流动资金，以满足营业规模快速扩张而产生的营运资金需求，保障公司可持续发展，具有合理性。

公司“高密度光互联产品生产建设项目”和“杰普特高密度光互联产品生产线建设项目”使用募集资金均投入资本性支出。本次募集资金非资本性支出为补充流动资金，金额为 40,000.00 万元，占本次募集资金的比例为 28.92%，不超过募集资金总额的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关监管规定。

三、项目土地、备案及其他相关手续进展情况

（一）募集资金投资项目土地取得情况

高密度光互联产品生产建设项目中“杰普特高密度光互联产品生产基地建设项目”涉及项目建设新增用地，公司已经取得土地使用权，产权证书编号：粤（2026）惠州市不动产权第 5024377 号。除前述项目以外，“杰普特高密度光互联产品生产线建设项目”、“杰普特总部及研发中心升级建设项目”和补充流动资金项目不涉及新增项目建设用地。

（二）募集资金投资项目发改委备案情况

1、高密度光互联产品生产建设项目

截至募集说明书签署日，“杰普特高密度光互联产品生产基地建设项目”已取得广东省企业投资项目备案证，项目代码：2604-441305-04-01-673847；“杰普特高密度光互联产品生产线建设项目”已取得广东省企业投资项目备案证，项目代码：2604-441305-04-02-187961。

2、杰普特总部及研发中心升级建设项目

截至募集说明书签署日，“杰普特总部及研发中心升级建设项目”已取得深圳市企业投资项目备案证，备案编号：深龙华发改备案〔2026〕395 号。

3、补充流动资金

本项目不涉及固定资产投资项目建设或者生产等事项，不适用相关主管部门关于固定资产投资的管理规定，无需履行相应的备案、核准或者审批手续。

（三）募集资金投资项目环评情况

1、高密度光互联产品生产建设项目

截至募集说明书签署日，“杰普特高密度光互联产品生产基地建设项目”已取得惠州市生态环境局出具的关于项目环境影响报告表的批复（惠市环（仲恺）建〔2026〕168号）；“杰普特高密度光互联产品生产线建设项目”已取得惠州市生态环境局出具的关于项目环境影响报告表的批复（惠市环（仲恺）建〔2026〕167号）。

2、杰普特总部及研发中心升级建设项目

截至募集说明书签署日，“杰普特总部及研发中心升级建设项目”环境影响登记表已完成备案，备案号：20264403000100000216。

3、补充流动资金

本项目不涉及固定资产投资项目建设或者生产等事项，无需履行环评报批手续。

四、募集资金用于扩大既有业务、拓展新业务的情形

本次募集资金投资项目中，“高密度光互联产品生产建设项目”的实施将有效提升公司现有光互联产品的产能，增强光通信领域关键器件的交付能力，属于扩大公司既有主营业务的投资项目。

（一）既有业务的发展情况

公司围绕光连接/光通信应用领域，面向数据中心、云计算、人工智能行业的产业需求，开发了 MPO/MMC 光纤连接器、光纤阵列单元 FAU 及各类光纤组件产品，相关产品主要应用于数据中心的服务器机柜，作为数据在整个数据中心内传输的重要组成部分。2025 年度，公司积极展开关于光通信领域 MPO、MMC、FAU 等光纤器件产品的布局，光纤器件业务收入迅速增长至 1.43 亿元，较 2024 年度增加 560.42%，产品已获得知名客户在质量以及交付能力方面的高度认可。

（二）扩大业务规模必要性及新增产能规模的合理性

1、受益于 AI 算力和数据中心需求快速增长，光通信市场迎来爆发

2025 年以来，受益于 AI 算力和数据中心需求快速增长，光通信市场景气度持续提升，全球各大云服务商及超大规模数据中心运营商不断上调资本开支计划。据 Bloomberg 数据，2026 年 Meta、谷歌、亚马逊和微软等四家公司的合计资本开支预计达 6,300-6,700 亿美元，同比增长约 70%。2026 年中国算力基建投入达到 5,000 亿元人民币水平。根据国际数据公司 (IDC) 与浪潮信息联合发布《2025 年中国人工智能计算力发展评估报告》，2024 年全球人工智能服务器市场规模为 1,251 亿美元，2025 年将增至 1,587 亿美元，2028 年有望达到 2,227 亿美元。同时，随着 CPO 技术逐步进入规模化商用阶段，单台 CPO 交换机可承载和输出的光纤通道数较传统方案将显著增加，相应将对关键光纤器件提出高密度的配置需求，以及更复杂的性能要求，以支持各端口光纤通道的高效稳定连接。在上述因素驱动下，光通信市场需求快速增长，光连接模块及器件作为光通信领域的关键基础组件相应迎来发展机遇，根据 LightCounting 测算，2026 年全球光模块数通市场 228 亿美元，至 2030 年复合增速为 20%；2026 年全球光模块电信市场 53 亿美元，至 2030 年复合增速为 7%。

2、发行人已有技术储备高度契合光通信器件生产加工

公司以自有激光器、激光/光学智能装备为基础，在产品研发与产业化过程中沉淀形成了激光光源、精密量测、运动控制、机器视觉、光学设计、元器件精密加工等重要技术储备，相关底层技术与光通信器件在加工工艺、光学耦合、精密装配、性能测试等领域高度契合，技术能力能够有效复用。公司将结合自身在激光加工、自动化制造及光学检测领域长期积累的技术优势，针对光通信高密度光纤器件制造工艺需求，加快研发光纤器件生产所需的自动化设备、激光设备及检测设备，推动光纤器件产品生产向规模化、智能化量产方向发展，保障产品的可靠性、稳定性以及一致性，同时提升生产效率、优化制造成本。公司将运用长期积累的激光技术充分赋能光通信核心器件业务，从而构建核心技术储备、关键设备自研、产品自动化生产和稳定交付能力等全方位优势。

3、发行人当前产能预计难以满足未来市场及客户需求，现有客户储备将有效保障新增产能消化

随着数据中心、云计算、人工智能行业对高密度、高带宽、低能耗光纤器件的需求

日益增长，同时 MPO、MMC、FAU 作为高端无源器件，技术壁垒显著，头部企业纷纷凭借产能规模与技术优势抢占市场份额。基于上述背景，公司现有产能预计难以满足未来市场及客户需求，因此，公司拟通过本次募集资金项目建设，打造规模化、柔性化、智能化光纤器件生产基地，进一步增强光纤器件批量交付能力，深度绑定头部客户的长期供货需求，积极把握“光+AI”融合创新的产业发展机遇，提升公司光纤器件业务的市场占有率和核心竞争力。

综上所述，“高密度光互联产品生产建设项目”扩大业务规模具有必要性，新增产能规模具备合理性。

五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）发行人的实施能力

1、人才储备

经过多年的发展，公司已建立以深圳和新加坡为中心的国际化研发团队，截至 2026 年 3 月 31 日，公司研发人员数量为 550 人，占公司员工总数比例为 18.05%。公司核心技术团队汇集了众多涉及光学设计、电子技术、精密机械、自动化、软件等不同学科背景的海外留学归国人才及国内高层次人才，拥有丰富的光学、自动化控制以及机器视觉检测等行业研发经验。同时，公司积极与高校、研究所、行业上下游头部企业等进行技术交流和有针对性的产品开发，已取得多项创新技术成果，并持续提升科研团队的自主创新能力和技术水平，强化内部培养体系。公司拥有优质的研发团队和健全的人才培养制度，能够有效保障主营业务的开展和本次募集资金投资项目的实施。

2、技术储备

公司以激光器核心技术驱动，以客户需求为导向，坚持具有自主知识产权产品的研发和创新，积极对具有商业化价值的科技成果进行转化生产，逐步构建了完善的研发组织架构和技术创新制度体系，掌握了多项具有重大突破的激光器及激光/光学智能装备的相关技术，在此基础上形成了自主知识产权的系列激光光源技术，其中多项核心技术属国内首创，各项指标和性能达到了国际先进或领先水平。

MPO、MMC、FAU 等光纤器件产品生产过程关键环节包括剥纤、穿纤、注胶、固

化、研磨和测试等，其中多个环节应用智能激光设备。公司能够结合自身在激光加工、自动化制造及光学检测领域长期积累的技术优势，加快研发光纤器件生产所需的自动化设备、激光设备及检测设备，进而提升产品生产效率、优化制造成本以及保障产品一致性，构建核心技术储备、关键设备自研、产品自动化生产和稳定交付能力等全方位优势。因此，公司深刻的行业理解和丰富的技术储备，能够为本次募集资金投资项目实施、产品矩阵拓展、激光技术升级迭代提供充分的技术支持。

3、市场储备

公司紧密跟踪客户需求和行业发展趋势开发多款核心产品，已形成激光器、激光/光学智能装备、光连接/光通信器件三大业务板块。历经十余年的科研积累和业务发展，公司客户遍布亚洲、北美、欧洲等地区，下游广泛涉及消费电子、半导体、PCB 制造、绿色能源、数据中心、云计算等多个行业，产品和服务已获得 A 公司、Meta、英特尔、国巨股份、厚声电子、意法半导体、风华高科、顺络电子、东山精密、胜宏科技、宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、一汽弗迪等全球知名客户的认可。

2025 年度以来，光通信市场因 AI 算力需求快速增长迎来了新一轮爆发，公司聚焦未来高速光互联解决方案，适时推出光连接模块、光纤阵列单元等核心产品并实现销售，在产品质量和交付能力两方面均获得客户的高度认可。较高的品牌知名度和稳定的客户关系，为公司本次募集资金投资项目的顺利实施奠定了坚实的市场基础。

（二）资金缺口的解决方式

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

六、募集资金用于研发投入的情况

本次募集资金未规划单独的研发投入项目。

七、本次募集资金投资属于科技创新领域

（一）本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明

公司主营业务为研发、生产和销售激光器、激光/光学智能装备和光纤器件，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。公司主营产品均属于技术密集型产品，其中激光器产品包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等，自主研发的 MOPA 脉冲光纤激光器在国内率先实现了批量生产和销售，填补了国内该领域的技术空白；围绕客户对激光技术解决方案的需求，公司持续开发智能光谱检测机、激光调阻机、PCB 软硬度板钻孔设备等多款激光/光学智能装备，广泛应用于激光精密加工、半导体光学检测、消费电子产品制造、贴片元器件制造等领域。同时，公司加快在光连接/光通信领域的战略布局，聚焦未来高速光互联解决方案，积极把握数据中心、云计算及人工智能等新兴应用带来的旺盛需求，研发推出 MPO、MMC、FAU 等光通信领域关键基础部件。因此，公司所处行业属于高新技术产业和战略性新兴产业，主营产品融合激光与光学、测试与测量、运动控制与自动化、机器视觉等领域的核心技术，主营业务属于科技创新领域。

本次募集资金投资项目包括高密度光互联产品生产建设项目、杰普特总部及研发中心升级建设项目及补充流动资金，有助于提高公司光连接/光通信关键器件交付能力，提升科技创新水平，强化公司综合竞争力，以及满足公司未来经营规模持续增长和技术研发所需的营运资金需求。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，规划项目面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

（二）募投项目实施促进公司科技创新水平提升

公司产品具有研发投入大、技术更新迭代快等特点。本次投资项目契合公司发展战略，与公司已有的技术储备与业务布局相结合，助力公司战略升级。公司作为国内激光行业的领先企业之一，在“激光器+”领域已长期积累技术优势，未来将坚定推进“光+AI”双向赋能战略。公司本次募集资金投入和项目产品主要面向下游 AI 算力、数据中心、高速网络等具有广阔发展前景的产业，加速布局光连接/光通信领域，重点提高 MPO、MMC、FAU 等关键光纤器件的技术水平和交付能力；同时，公司将持续加大对

激光行业前沿领域，尤其是针对飞秒激光器的研发投入，加速新技术成果转化和新产品产业化。本次募投项目实施将进一步提升公司的科技创新水平、研发实力和综合竞争力，有望打造公司第二增长曲线。

八、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目聚焦公司主营业务，顺应行业发展趋势，符合公司发展规划。项目实施有利于公司切实推进“光+AI”双向赋能战略，进一步加大新一代激光技术、高密度光互连、光学检测、半导体先进封装等重点领域的研发投入，拓宽产品矩阵，进而全面提升公司在激光产业的技术先进水平、市场竞争力以及盈利能力，以实现公司持续高质量增长，维护股东长远利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资金实力将有效提升，总资产和净资产规模有所增长，资产负债率下降。虽然募集资金投资项目从建设投产到产生经济效益需要时间，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能存在一定程度的摊薄。但项目市场前景良好，从长远来看，随着项目预期效益实现，公司盈利能力将会进一步增强。

第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，是公司紧抓行业快速扩张机遇、实现战略发展目标的重要举措，有利于公司充分利用在“激光器+”领域长期积累的技术优势，坚定推进“光+AI”双向赋能战略，进一步加大新一代激光技术、高密度光互联产品、光学检测、半导体先进封装等重点领域的研发投入，提高光纤器件产品交付能力，同时增强研发实力，进而提升公司在激光产业的技术先进水平、市场竞争力以及盈利能力。本次发行完成后，公司主营业务不会发生重大变化，公司不涉及业务和资产的整合计划。

二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化

本次募投项目契合公司主营业务的发展方向，并与公司已有的技术储备与业务布局相结合，进一步推动公司“光+AI”战略升级并打造第二增长曲线。本次募投项目的实施有利于促进公司提升高密度光互联器件交付能力，夯实激光行业竞争力、提升激光产品技术水平、提升具有发展潜力的行业市场渗透率、提升交付完整解决方案的能力，促进公司科技创新水平的持续提升。

三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会、上交所规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。本次发行完成后，公司股东结构将有所变化。

根据本次发行的股票数量上限 28,514,826 股测算，且考虑发行人目前较为分散的股权结构，本次发行完成后，黄治家仍拥有发行人的控制权，仍保持控股股东、实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

综上所述，本次向特定对象发行股票完成后，公司股本将相应增加，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，但不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股本结构发生重大变化。

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

本次发行完成后，不会导致公司在业务经营方面与控股股东及实际控制人以及其控制的其他企业之间新增同业竞争。

五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。公司将严格按照中国证监会、上交所及公司内部规定履行必要程序，遵循公允、合理的市场定价原则，保证交易的合法性和交易价格的公允性。

第五章 最近五年内募集资金使用情况

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”

公司最近五个会计年度不存在通过首发、配股、增发、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。

因此，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需出具前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

第六章 本次发行相关的风险因素

一、本次向特定对象发行 A 股相关风险

（一）审批风险

本次发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册等。本次发行能否获得上述批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（二）发行风险

本次发行只能向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定对象定向发行股票募集资金，发行价格不低于定价基准日（即发行期首日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，且发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响，公司本次发行存在募集资金不足甚至无法成功实施的发行风险。

（三）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

本次发行募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将会大幅增加，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项目产生效益之前，公司的利润和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，本次发行可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。

此外，若公司本次发行募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能相应增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

二、技术风险

（一）技术升级迭代风险

激光相关产业发展速度较快，企业需通过不断的技术升级迭代维持或提升产品性能和技术水平，公司存在因技术升级迭代速度缓于产业发展速度而导致产品竞争力降低的风险。

（二）研发失败风险

激光器、激光/光学智能装备属于技术密集型产品，公司在根据市场和客户需求进行新产品研发时，存在因未能正确理解行业及相关核心技术的发展趋势或无法在新产品、新工艺、新材料等领域取得进步而导致研发失败的风险。

（三）技术未能形成产品或实现产业化等风险

激光器、激光/光学智能装备从技术到应用需要较多的实施经验，公司研发的技术存在因稳定性差、应用难度大、成本高昂、与下游客户需求不匹配等因素而导致不能形成产品或实现产业化的风险。

（四）核心技术泄露的风险

公司主营业务产品属于技术密集型产品，当前公司多项产品和技术处于研发阶段，公司存在因核心技术泄露而导致产品竞争力下降的风险。

三、经营风险

（一）市场竞争风险

公司的产品在国内外均有一定数量的竞争对手，存在部分竞争对手采用低价竞争等策略激化市场竞争态势，对公司产品的销售收入和利润率产生了负面影响。随着激光器市场竞争的进一步加剧，公司激光器的平均毛利率将可能出现一定幅度的下降，将可能导致利润总额出现大的降幅。

（二）单一类别定制化智能装备产品收入下滑的风险

由于公司智能装备主要为根据客户实际需求进行技术方案设计开发，定制化程度较高，因此单一类别装备产品的销量取决于对应客户的需求，而客户对于单一类别产品的需求在各年波动较大，导致公司单一类别定制化智能装备收入存在大幅波动的风险。

（三）新业务新产品市场拓展风险

公司在光连接/光通信、PCB 制造、绿色能源、VR/AR 等新领域持续开发新技术新产品，公司存在在上述新领域随着行业竞争加剧导致业务拓展不理想的风险。

（四）市场或行业政策变化风险

公司业务的下游行业较为集中，其中人工智能、消费电子、半导体、绿色能源等行业与国家的产业经济政策密切相关。公司存在因国家产业政策调整或宏观经济出现周期性波动等因素导致下游产业发展不达预期，而使公司业务增长速度放缓，甚至业绩下降的风险。

（五）国际贸易环境不稳定的风险

近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护措施，我国部分产业发展受到一定冲击。集成电路和半导体行业具有典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对集成电路和半导体产业链上下游公司的生产经营产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而可能对公司的经营带来不利影响。

（六）客户集中度较高和激光/光学智能装备业务存在大客户依赖的风险

报告期各期，公司前五大客户销售额分别为 38,787.41 万元、56,320.91 万元、91,815.24 万元、38,691.33 万元，占公司营业收入的比例分别为 31.65%、38.74%、44.27%、58.55%。由于下游行业竞争激烈，以及宏观经济波动、技术更新换代等因素导致大客户需求不断变化提升，如果大客户未来因选择其他供应商等原因减少对公司产品的采购量，可能会对公司整体业务的销售收入、毛利率和净利润等指标构成较大不利影响。

（七）海外销售的风险

公司境外收入是公司重要的收入和利润来源，未来一段时间内对海外市场尤其是欧洲、美国、中国台湾地区市场的销售额仍然较高。报告期各期，公司境外销售额分别为 23,085.03 万元、20,943.16 万元、35,735.71 万元、21,809.91 万元，占公司营业收入的比例分别为 18.85%、14.41%、17.24%、33.03%。公司存在因海外市场发生较大波动或产品主要进口国家及地区政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化，而导致公司海外销售收入下降的风险。

（八）部分原材料境外采购的风险

报告期内，公司境外采购（含向境外厂商或其在国内的代理商）原材料的采购金额

占原材料采购总额的比重高。未来一段时间内公司将继续从欧洲、美国、日本等境外国家和地区采购原材料，受近期国际贸易局势影响，公司存在因原材料出口国贸易政策发生不利变化进而影响公司的业务发展的风险。

（九）租赁房产产权瑕疵

发行人及子公司深圳矩阵租入的部分厂房和办公室，出租方未能提供房屋所有权证书或产权人授权其出租的证明，存在因出租方不享有租赁房屋所有权或转租权无权出租该等房屋而使租赁合同无法履行的风险。未来如果因为产权瑕疵、出租方违约而使得相关房产无法继续租赁的，则公司及深圳矩阵的部分厂区和办公室将需要更换至其他场所，公司将产生包括人工和运输费、现有厂房装修费损失，将在短期内对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。

四、财务风险

（一）汇率波动风险

近年来，公司产品销售收入中外销收入比重较高，公司境外销售通常以美元、新加坡元为主进行定价和结算，人民币汇率波动会对公司收入和汇兑损益产生影响，从而对公司经营业绩带来一定程度的不确定性。

（二）应收账款违约及周转率下降的风险

公司 2023 年末、2024 年末、2025 年末、2026 年 3 月末的应收账款净额分别为 36,836.44 万元、50,689.76 万元、52,805.90 万元和 61,864.89 万元，占流动资产的比重分别为 21.10%、26.94%、21.63%和 23.14%，应收账款净额较大，公司存在因客户应收账款违约（包括客户故意拖欠应付款项、客户经营业绩不佳无力清偿情况等）而导致公司款项无法收回、产生坏账损失的风险。

（三）税收优惠政策变化风险

报告期内，公司享受高新技术企业所得税减免、软件产品增值税即征即退等税收优惠，公司所享受的各项税收优惠均符合国家有关法律法规的规定，该类税收优惠属于国家层面鼓励产业发展的宏观政策，如果国家调整上述税收政策，公司及其子公司未能持续被认定为符合税收优惠条件，将对公司未来经营业绩造成一定不利影响。

五、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目是公司基于行业发展趋势、市场容量、客户需求以及公司未来产能布局、经营状况和技术储备等充分调研的基础上，经审慎论证后确定的，具有较强的可行性和必要性，项目实施有利于公司业务发展并符合公司的发展战略。公司基于历史数据、未来行业和公司的发展趋势对本次募投项目的资金投入和预计效益进行了合理测算，但在募投项目的实施过程中，公司将可能会受到市场环境变化、行业增速放缓、技术路径变更、原材料价格波动等不确定或不可控因素的影响，本次募集资金投资项目存在不能完全实现预期目标或效益的风险。

六、募投产能消化风险

本次募集资金投资项目已经经过充分的可行性分析论证，但从产能消化角度，如果未来下游 AI 行业、数据中心市场发展不及预期，或者产品技术迭代加快、行业竞争加剧导致本次募投项目相关产品的市场需求大幅减弱，以及公司与境外重要客户的合作可能受贸易政策、地缘政治等因素的影响导致中断，将导致募投项目产能不能按预期充分消化的情形，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

七、募集资金投资项目实际效益不及预期的风险

公司本次募投项目预计达到的效益是综合考虑当前经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力和产品竞争力等因素做出的测算，公司经过审慎分析后认为本次募投项目将实现良好的经济效益。但是考虑未来的经济形势、行业发展趋势、市场竞争环境等存在不确定性，以及募投项目在实施过程中可能会面临成本增加、进度延迟和市场需求变化等方面的风险，因此存在募集资金投资项目实际效益不及预期的风险。

八、人才流失风险

人才是激光产业和光通信领域相关技术发展的核心，高素质的研发人员是公司持续

进行技术创新、产品拓展和增强核心竞争力的基础，公司如果无法持续提供具有竞争力的薪酬待遇和高质量的发展平台，则可能出现人才流失的情形，进而对公司的技术创新和产品的研发造成不利影响。

第七章 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：



黄治家



刘健



CHENG XUE PING

(成学平)



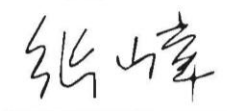
朱江杰



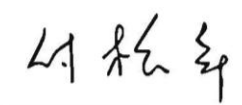
刘明



黄淮



张嶂



付松年



刘雪生



深圳市杰普特光电股份有限公司

2026 年 8 月 7 日

一、发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事会审计委员会委员签字：



张璋



刘雪生



朱江杰



深圳市杰普特光电股份有限公司

2026 年 8 月 7 日

一、发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：



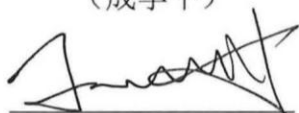
CHENGXUEPING
(成学平)



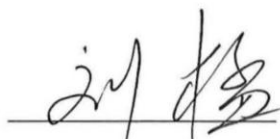
刘明



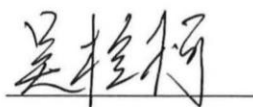
黄淮



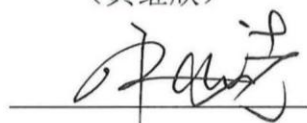
HUANGJIXIN
(黄继欣)



刘猛



吴检柯



杨浪先



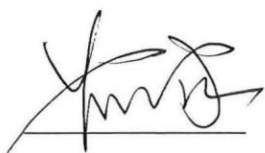
深圳市杰普特光电股份有限公司

2016 年 8 月 7 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签名：



黄治家

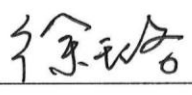


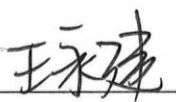
三、保荐人声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：_____ 
陈亮

保荐代表人：_____ 
张林冀

_____ 
徐 璐

项目协办人：_____ 
王永建



保荐人董事长声明

本人已认真阅读深圳市杰普特光电股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任

董事长：



陈亮



保荐人总裁声明

本人已认真阅读深圳市杰普特光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总裁：



王曙光

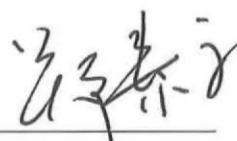


（四）发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

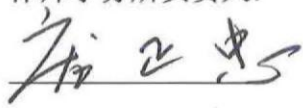
经办律师：


刘胤宏


郑素文


宋颖怡

律师事务所负责人：


庞正忠


北京金诚同达律师事务所
2026 年 8 月 7 日

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书, 确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议, 确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

签字注册会计师:

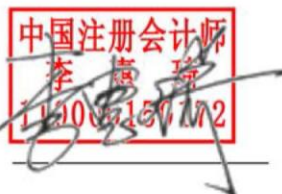


桑涛



吴静

会计师事务所负责人:



李惠琦

致同会计师事务所(特殊普通合伙)
2026 年 8 月 7 日



六、发行人董事会声明

1、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票对普通股股东即期回报摊薄的影响，为保护投资者利益，填补本次向特定对象发行股票可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力，具体如下：

（1）加强募集资金管理，保证募集资金使用规范

公司已按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定，公司将根据相关法律法规和募集资金管理制度的相关要求，规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

根据募集资金管理制度规定，本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

（2）加快公司主营业务的发展，提高公司盈利能力

本次发行募集资金将主要投入“高密度光互联产品生产建设项目”、“杰普特总部及研发中心升级建设项目”及补充流动资金，该募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，项目实施后，将进一步扩大公司的业务规模，提高公司的核心竞争力。本次发行募集资金到位后，公司将加快募集资金投资项目建设的推进，力争早日实现预期收益，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

（3）完善公司治理，为企业发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，为公司发展提供制度性保障。确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权、作出决策，确保独立董事能够认真

履行职责，维护公司的整体利益和股东的合法权益。

（4）完善利润分配政策，重视投资者回报

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为了完善和健全公司的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，切实保护公众投资者的合法权益，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制订了《深圳市杰普特光电股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

2、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体如下：

（1）公司董事、高级管理人员的承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺支持董事会或薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将在自身职责和权限范围内促使公司未来的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

8、本承诺函至以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人不再作为公司的董事/高级管理人员；（2）公司股票终止在上海证券交易所上市；（3）本次发行终止。”

（2）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的承诺

公司控股股东、实际控制人黄治家及其一致行动人黄淮对公司本次发行摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺：

“1、本人承诺依照相关法律、法规及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照上述监管部门的最新规定出具补充承诺。

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

4、本承诺函至以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人不再作为公司的控股股东/实际控制人或其一致行动人；（2）公司股票终止在上海证券交易所上市；（3）本次发行终止。

（此页无正文，为《深圳市杰普特光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书发行人董事会声明》之盖章页）

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2026 年 8 月 7 日

A red circular stamp is positioned over the text. The outer ring of the stamp contains the text "杰普特光电股份有限公司" (Jiepute Optoelectronics Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star.